

**Jahresabschluss
zum 30. September 2000
und Lagebericht**

**Infineon Technologies AG
München**

JAHRESABSCHLUSS zum 30. September 2000

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EURO

Geschäftsjahr 01.10.99 – 30.09.2000

	1999/2000	% vom Umsatz	Rumpfgeschäftsjahr 1.4.-30.9.1999
Umsatzerlöse	7.626		2.574
Umsatzkosten	(5.428)	(71,2)	(2.023)
Bruttoergebnis vom Umsatz	2.198	28,8	551
Forschungs- und Entwicklungskosten	(938)	(12,3)	(412)
Vertriebskosten	(170)	(2,2)	(178)
Allgemeine Verwaltungskosten	(192)	(2,5)	(106)
Sonstige betriebliche Erträge	39		1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(4)		(16)
	933	12,2	(160)
Beteiligungsergebnis	18		92
Finanzergebnis	(50)		(13)
	(32)	(0,4)	79
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und Jahresfehlbetrag	901	11,8	(81)
Steuern vom Einkommen und Ertrag	(381)		0
Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	520	6,8	(81)
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	(81)		0
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	(32)		0
Bilanzgewinn (i. Vj. Bilanzverlust)	407	5,3	(81)

Bilanz in Mio. EURO

Aktiva	30.09.00	30.09.99
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	178	62
Sachanlagen		
Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.798	1.472
Kumulierte Abschreibungen	(1.200)	(1.104)
	<u>598</u>	<u>368</u>
Finanzanlagen	4.814	4.180
	5.590	4.610
Umlaufvermögen		
Vorräte	264	197
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	2.297	1.005
Flüssige Mittel	244	796
	<u>2.805</u>	<u>1.998</u>
Summe Aktiva	8.395	6.608

Passiva	30.09.00	30.09.99
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.251	400
Kapitalrücklage	4.586	4.567
Andere Gewinnrücklagen	32	0
Bilanzgewinn (i.Vj. Bilanzverlust)	407	(81)
	<u>6.276</u>	<u>4.886</u>
Sonderposten mit Rücklagenanteil	5	5
Rückstellungen		
Pensionen	121	107
Übrige Rückstellungen	868	486
	<u>989</u>	<u>593</u>
Verbindlichkeiten	1.108	1.124
Rechnungsabgrenzungsposten	17	0
Summe Passiva	8.395	6.608

Anhang der Infineon Technologies AG für das Geschäftsjahr 01.10.1999 – 30.09.2000

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Infineon Technologies AG auf den 30. September 2000 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) erstellt. Gegenüber dem Rumpfgeschäftsjahr des Vorjahres für den Zeitraum 01. April bis 30. September 1999 umfasst das Berichtsjahr erstmals ein volles Geschäftsjahr über 12 Monate für den Zeitraum 01. Oktober 1999 bis 30. September 2000.

Die Gesellschaft stellte am 05. November 1999 mit rückwirkender Wirkung zum 01. Oktober 1999 auf die Hauswährung EURO um. Alle folgenden Angaben lauten deshalb auf Euro. Vorjahreswerte in DM wurden in Euro umgerechnet.

Einzelne Posten der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz haben wir zusammengefasst. Diese Posten sind im Anhang gesondert ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über maximal 5 Jahre oder die längere vertragliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Berichtszeitraum angeschaffte immaterielle Vermögensgegenstände unterliegen einer Abschreibung zu 75% einer vollen Jahresabschreibung.

Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert und unterliegen einer planmäßigen Abschreibung. Soweit steuerrechtlich möglich, schreibt die Gesellschaft Sachanlagevermögen mit den zulässigen Höchstsätzen degressiv ab. Im Berichtszeitraum angeschaffte Vermögensgegenstände unterliegen einer Abschreibung zu 75% einer vollen Jahresabschreibung.

Die Gesellschaft geht von der degressiven auf die lineare Abschreibungsmethode über, sobald diese zu höheren Abschreibungen führt.

Übersicht über die Nutzungsdauer der Sachanlagen

Fabrik- und Geschäftsbauten	20 bis 50 Jahre
Übrige Bauten	5 bis 10 Jahre
Technische Anlagen u. Maschinen	5 bis 10 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	überwiegend 5 Jahre

Außerplanmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens werden von der Gesellschaft vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Geringwertige Wirtschaftsgüter schreibt die Gesellschaft im Zugangsjahr voll ab.

Geleistete Anzahlungen und angefallene Teilerstellungskosten auf noch nicht fertiggestellte Investitionen unterliegen keiner Abschreibung.

Die Gesellschaft wendet die Festbewertung für Spezial- und Normalwerkzeuge an.

Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten aktiviert. Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen niedrigeren Wert am Bilanzstichtag werden vorgenommen, wenn die Wertminderung als voraussichtlich dauerhaft angesehen wird.

Umlaufvermögen

In den Vorräten werden Rohstoffe und Waren zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt. Erzeugnisse wurden mit den Herstellungskosten bewertet, die den steuerrechtlichen Vorschriften entsprechen. Fremdkapitalzinsen sind in die Herstellungskosten nicht einbezogen worden.

Für die Bewertung bestimmter Vorräte wird das Lifo-Verfahren angewendet. Abwertungen werden für Bestandsrisiken, die sich aus erhöhter Lagerdauer und geminderter Verwertbarkeit ergeben, in angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag bzw. zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten des Abschlußstichtages angesetzt. Abschreibungen auf Forderungen werden entsprechend der Wahrscheinlichkeit des Ausfalls sowie nach Länderrisiken gebildet.

Unverzinsliche und innerhalb der marktüblichen Verzinsung liegende Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr sind abgezinst.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Für bei der Gesellschaft bestehende Pensionsverpflichtungen werden Rückstellungen bilanziert. Der ausgewiesene Bilanzwert beruht auf einem versicherungsmathematischen Gutachten. Zugrunde gelegt wurden bei der Bewertung der Rückstellung die Richttafeln 1998 von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Die handelsrechtliche Bewertung der angesetzten Rückstellung weicht von den steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften ab.

Auf zeitlich befristete Unterschiede zwischen dem Handelsbilanzergebnis und dem steuerrechtlichen Einkommen grenzt die Gesellschaft latente Steuern auf der Basis der

bei der Auflösung des Bewertungsunterschieds erwarteten Steuerbe- oder entlastung ab. Die Gesellschaft wendet die Verbindlichkeitsmethode an.

In den sonstigen Rückstellungen bildet die Gesellschaft für alle erkennbaren Risiken aus ungewissen Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in angemessenem und ausreichendem Umfang individuelle Vorsorge.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen werden offen von dem Aktivposten „Vorräte“ abgesetzt.

Erlöse, Kosten und Aufwendungen

Umsatzerlöse werden ausgewiesen, wenn die Lieferungen oder Leistungen ausgeführt sind und der Gefahrenübergang erfolgt ist.

Forschungs- und Entwicklungskosten werden in voller Höhe nach Abzug der Fördermittel als Aufwand gebucht.

Währungsumrechnung

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten werden zum Einbuchungskurs bzw. jeweils zum ungünstigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet.

Währungs- und Zinsrisiken

Zur Sicherung des Unternehmens gegen Währungsrisiken werden im wesentlichen Devisentermingeschäfte, Währungsswaps sowie Optionen eingesetzt. Derivative Finanzinstrumente werden nur zu Sicherungszwecken verwendet.

Bilanzpositionen in Fremdwährung werden vollständig gesichert, schwebende Geschäfte und geplante Umsätze innerhalb vorgegebener Risikolimits.

Derivative Finanzinstrumente, die für geplante Umsätze des nächsten Geschäftsjahrs und für sonstige schwebende Geschäfte abgeschlossen wurden, bewerten wir imparitätlich, d.h. für negative Marktwerte werden Rückstellungen gebildet, positive Marktwerte werden nicht angesetzt.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Oktober 1999 bis 30. September 2000

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung umfaßt die Werte des Berichtszeitraumes und des vergangenen Rumpfgeschäftsjahres.

Umsatzerlöse

Die Umsätze gliedern sich nach Segmenten wie folgt: in Mio. €

Segmente	
Automobil- und Industrieelektronik	833
Drahtgebundene Kommunikation	1.100
Mobile Kommunikation	1.406
Speicherprodukte	3.611
Sicherheits- und Chipkartensysteme	357
Optoelektronische Komponenten	264
Sonstiges	55
Summe	7.626

Für den vergleichbaren Umsatz im Rumpfgeschäftsjahr 1999 in Höhe von 2.574 Mio. € liegt eine entsprechende Aufteilung auf diese Segmente nicht vor. Ein aussagefähiger Vergleich ergibt sich aus dem Konzernabschluss.

Die Umsatzaufgliederung nach Abnehmergruppen stellt sich für den Berichtszeitraum wie folgt dar:

Abnehmergruppen	Berichtsjahr	Vorjahr
Umsätze mit Infineon Gesellschaften	4.950	1.185
Umsätze mit Siemens AG	617	271
Umsätze an Fremde über Landesgesellschaften der Siemens AG	349	442
Umsätze an Fremde direkt	1.710	676
Summe	7.626	2.574

Die Umsatzerlöse beinhalten Lizenzzerträge in Höhe von Mio. € 23,1 (Vorjahr: Mio. € 41,5).

Material- und Personalaufwand

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Materialaufwand und Personalaufwand wie folgt enthalten:

	Berichts- jahr	Vorjahr (Rumpfge- schäftsjahr)
Materialaufwand in Mio. €		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.533	1.715
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.196	478
Summe	5.729	2.193
Personalaufwand in Mio. €		
Löhne und Gehälter	606	214
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	87	38
Aufwendungen für Altersversorgung	19	8
Summe	712	260

Die durchschnittliche Anzahl und die Struktur der Mitarbeiter der Gesellschaft zeigen die folgenden Übersichten:

Standort	Anzahl Berichtsjahr	Anzahl Vorjahr
München	5.938	5.231
Regensburg	3.171	3.147
Berlin	372	378
Sonstige Inland	352	335
Summe	9.833	9.091

Struktur	Anzahl Berichtsjahr	Anzahl Vorjahr
Leitende Angestellte	206	155
Außertariflich Angestellte	1.752	1.508
Tarifangestellte	4.504	4.023
Summe Angestellte	6.462	5.686
Gewerbliche Mitarbeiter	3.371	3.405
Summe	9.833	9.091

Forschungs- und Entwicklungskosten

Forschungs- und Entwicklungskosten werden nach Abzug der Fördermittel in voller Höhe als Aufwand gebucht. Von den Forschungs- und Entwicklungskosten sind Zuschüsse in Höhe von Mio. € 23,3 (Vorjahr: Mio. € 9,3) abgesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u.a. realisierte Gewinne aus Devisensicherungsgeschäften in Höhe von 21 Mio. Euro und Erträge aus der Erweiterung der Entwicklungskooperation mit IBM durch Beitritt eines weiteren Partners in Höhe von 10 Mio. Euro.

Beteiligungsergebnis

Das Beteiligungsergebnis strukturiert sich im Geschäftsjahr 1999/2000 wie folgt:

In Mio. €	Berichtsjahr	Vorjahr
Erträge aus Beteiligungen	18	79
Davon aus verbundenen Unternehmen	16	79
Gewinne aus dem Abgang von Beteiligungen	–	13
Summe	18	92

Finanzergebnis

In Mio. €	Berichtsjahr	Vorjahr
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(133)	(17)
Summe	(50)	(13)

Von den Zinserträgen entfielen 82,4 Mio. € und bei den Zinsaufwendungen 25,1 Mio. € auf verbundene Unternehmen.

Steuern

Als Ertragsteueraufwendungen werden die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer ausgewiesen. Hiermit verrechnet wird die Verminderung der latenten Steuerpflichtung in Höhe von 48,1 Mio. €.

Sonstige Steuern sind mit 1,1 Mio. € unter den Funktionskosten erfasst.

Erläuterungen zur Bilanz zum 30. September 2000

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der beigefügten Anlage 3/13 dargestellt.

Die Zugänge bei den Immateriellen Vermögensgegenständen betreffen mit 130,5 Mio. € Know How-Erwerb von der Savan Communication Ltd. Israel.

Die Aufstockung der Beteiligung an der Infineon Technologies Holding B.V. um 570,0 Mio. € steht im Zusammenhang mit dem Resterwerb der Anteile und der Finanzierung der White Oak Semiconductor, Richmond, USA.

Für 50,1 Mio. € wurden Anteile an Venture-Gesellschaften erworben.

Am 01.08.2000 wurde die Infineon Technologies Image & Video GmbH & Co KG mit einem Buchwert von 10,1 Mio. € ausgegliedert.

Als Ausleihungen sind Darlehen an Beteiligungsunternehmen mit 0,5 Mio. € und sonstige Ausleihungen mit 2,1 Mio. € bilanziert.

Eine Aufstellung über die wesentlichen Beteiligungen zeigt Anlage 3/14. Eine vollständige Aufstellung des Anteilsbesitzes wird beim Handelsregister des Amtsgerichts München hinterlegt.

Umlaufvermögen

Vorräte

In Mio. €	Berichtsjahr	Vorjahr
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	29	15
2. Erzeugnisse und Waren	237	182
3. erhaltene Anzahlungen	(2)	-
Summe	264	197

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Struktur der Forderungen zeigt nachfolgende Übersicht:

In Mio. €	Berichtsjahr	Vorjahr
Lieferungen und Leistungen	559	309
Verbundene Unternehmen	1.436	508
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	109	105
Sonstige Vermögensgegenstände	193	83
Summe	2.297	1.005

Die Restlaufzeit der Forderungen liegt bis auf 59 Mio. € betreffend die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen unter einem Jahr.

Flüssige Mittel

Die im Vorjahresabschluss dokumentierte Sicherungseinlage für ein Darlehen an die Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden, wurde im Zuge der Rückführung des Darlehens aufgelöst.

Eigenkapital

In Mio €	Berichtsjahr	Vorjahr
Gezeichnetes Kapital	1.251	400
Kapitalrücklage	4.586	4.567
- davon aus Agiobeträgen	820	-
- davon aus anderen Zuzahlungen	3.766	4.567
Gewinnrücklagen	32	0
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	407	(81)
Summe	6.276	4.886

Grundkapital

Das Grundkapital der IFX AG beträgt am 30. September 2000 € 1.251.003.014 und setzt sich aus 625.501.507 auf den Namen lautende Stückaktien zum rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 2 zusammen. Gegenüber dem Grundkapital des Vorjahres von € 400.000.000 hat die Hauptversammlung die Erhöhung des Grundkapitals um € 848.584.860 beschlossen.

Die Satzung der Gesellschaft ermächtigt den Vorstand dazu, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Insgesamt bestehen drei Genehmigte Kapitalien (Genehmigtes Kapital I bis III) über insgesamt 480 Mio. €.

Der Vorstand hat von der ihm in der Satzung eingeräumten Ermächtigung Gebrauch gemacht, aus dem Genehmigten Kapital das Grundkapital durch Ausgabe von 1.209.077 Stück neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen € 2.418.154 Sacheinlage zu erhöhen. Die Grundkapitalerhöhung dient dem teilweisen Ausgleich der mit den von SAVAN Communications Ltd., Netanya, Israel, übernommenen Assets entstandenen Verpflichtungen. Der die Grundkapitalerhöhung übersteigende Betrag der Sacheinlagen erhöht mit € 39.899.541 die Kapitalrücklage.

Das Grundkapital wurde von den Aktionären vollständig eingezahlt. Die Aktien zum 30. September 2000 sind für das Geschäftsjahr 1999/2000 voll gewinnberechtigt. Die Kapitalerhöhungen sind im Handelsregister eingetragen.

Mitarbeiteraktienoptionen, Wandelschuldverschreibungen u.ä.

Der Vorstand der Infineon AG hat gemäß dem „stock options plan 1999“ an Mitarbeiter der Gesellschaft und Mitarbeiter von verbundenen Unternehmen Optionen auf den Erwerb von je einer Aktie pro Option in Höhe von 4.588.268 Stück ausgegeben. Davon sind 4.505.968 Optionen existent.

Wandelschuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere wurden im Berichtszeitraum von der Gesellschaft nicht begeben. Der Vorstand ist aber ermächtigt, Options- und Wandelschuldverschreibungen auszugeben.

Kapitalrücklage

Die Gesellschaft strukturiert die Kapitalrücklage nach der Art ihrer Entstehung:

Als Kapitalrücklage sind einerseits Agiobeträge auszuweisen, die bei der Ausgabe von Anteilen über den Nennbetrag hinaus erzielt wurden. Diese Kapitalrücklage entsteht im Berichtszeitraum durch Zugänge aus der Beteiligung von Intel zu € 243.641.105, dem Börsengang vom 13. März 2000 zu € 536.268.913 und der Beteiligung von SAVAN Communications Ltd. zu € 39.899.541 mit insgesamt € 819.809.560.

Die Kapitalrücklage, in der andere Zuzahlungen der Gesellschafter in das Eigenkapital dargestellt werden, mindert sich gegenüber dem Vorjahresbestand von € 4.566.644.815 um € 800.000.000 auf € 3.766.644.815 aus den beiden Grundkapitalerhöhungen von je € 400.000.000, die von der Hauptversammlung am 08. Dezember 1999 und 09. Februar 2000 beschlossen und am 26. Januar 2000 und am 14. Februar 2000 im Handelsregister eingetragen wurden.

Gewinnverwendung

Der Vorstand hat gemäß § 58 Abs. 2 AktG 32 Mio. € in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von 0,65 € je auf den Namen lautenden Stückaktie zu zahlen. Sofern die Hauptversammlung dem Vorschlag zustimmt, wird insgesamt ein Betrag von 407 Mio. € (im Vorjahr 0 €) zur Ausschüttung kommen.

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß Satzung um bis zu 146 Mio. € bedingt erhöht.

Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten mit Rücklageanteil über Mio. € 4,8 (Vorjahr: Mio. € 5,2) erfasst als Wertberichtigung zum Anlagevermögen steuerrechtliche Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen sowie steuerfreie Rücklagen gemäß § 6b Einkommensteuergesetz, § 4 Fördergebietsgesetz, § 14 Berlinförderungsgesetz, § 7d Einkommensteuergesetz. Der Sonderposten löst sich rätierlich entsprechend der Nutzungsdauer der betroffenen Vermögensgegenstände ertragswirksam auf. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens über Mio. € 0,4 (Vorjahr: Mio. € 0,2) enthält die Position „Sonstige betriebliche Erträge“ der Gewinn- und Verlustrechnung.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen von 868 Mio. € (i. Vj. 486 Mio. €) entfallen überwiegend auf laufende Steuern (238 Mio. € gegenüber 0 Mio. € im Vorjahr) sowie auf latente Steuern (266 Mio. € gegenüber 314 Mio. € im Vorjahr). Darüber hinaus enthalten sie abgegrenzte Aufwendungen aus dem Personalbereich, dem laufenden Geschäft und Restukturierungen.

Verbindlichkeiten

Die bilanzierten Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von unter einem Jahr und gliedern sich wie folgt.

in Mio. €	Berichtsjahr	Vorjahr
Lieferungen/Leistungen	218	125
Verbundene Unternehmen	385	819
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	196	103
Sonstige	309	77
Davon aus Steuern	68	26
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	67	49
Summe	1108	1.124

Am Bilanzstichtag bestehen nicht bilanzierte Zahlungsverpflichtungen aus Leasingverträgen für Immobilien-Objekte sowie aus langfristigen Mietverträgen für Anlagengegenstände. Nach den vertraglichen Bedingungen sind der Gesellschaft die Leasing-Objekte nicht als wirtschaftliches Eigentum zuzurechnen. Die Verpflichtungen aus den geschlossenen Leasing- und Mietverträgen belaufen sich innerhalb des nächsten Jahres auf 56 Mio. € und für den Zeitraum zwischen 1 und 5 Jahren auf insgesamt 169 Mio. €. Davon entfallen auf verbundene Unternehmen 48 Mio. € bzw. 134 Mio. €.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Abgegrenzt wurden Erträge aus neuen Lizenzverträgen. Diese Erträge resultieren aus Vorauszahlungen, die vereinbarte Leistungen der Infineon Technologies im kommenden Geschäftsjahr betreffen.

Sonstige Angaben

Bezüge des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Die Bezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 457.292 €. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates Wertsteigerungsrechte, für die eine Rückstellung gebildet wurde.

Die Bezüge der fünf Vorstandsmitglieder betragen im Geschäftsjahr 28,4 Mio. €. Sie setzen sich aus festen Gehaltsbestandteilen (1,1 Mio. €, im Vorjahr 0,5 Mio. €) einer erfolgsabhängigen Vergütung (13,8 Mio. €, im Vorjahr 1,3 Mio. €) sowie dem Gegenwert eingeräumter Aktienoptionen (13,5 Mio. €, im Vorjahr 0 Mio. €) zusammen. Es wurden keine Darlehen gewährt und es erfolgte keine Darlehenstilgung.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von 583 Mio. €, wovon 578 Mio. € auf Kreditbürgschaften gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungen entfallen.

Entwicklung des Anlagevermögens in Mio. EURO

	01.10.99	Zu- gänge	Um- bu- chun- gen	Ab- gänge	30.09.00	Kumulierte Abschrei- bungen	Netto- wert 30.09.00	Netto- wert 01.10.99	Abschrei- bungen des Ge- schäfts- jahres
Immaterielle Vermögensgegenstände									
Patente, Lizenzen und ähnliche Rechte, sowie Geschäfts- oder Firmenwert	195	175	0	-2	368	-190	178	62	-57
	195	175	0	-2	368	-190	178	62	-57
Sachanlagen									
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	119	4	0		123	-91	32	33	-4
Technische Anlagen und Maschinen	829	106	21	-41	915	-701	214	177	-85
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	489	90	12	-43	548	-408	140	123	-82
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35	210	-33	0	212		212	35	
	1.472	410	0	-84	1.798	-1.200	598	368	-171
Finanzanlagen									
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.781	576		0	4.357		4.357	3.781	
Beteiligungen	232	57			289		289	232	
Wertpapiere des Anlagevermögens	166	0			166		166	166	
Sonstige Ausleihungen	1	1		0	2		2	1	
	4.180	634	0	0	4.814	0	4.814	4.180	0
	5.847	1.219	0	-86	6.980	-1.390	5.590	4.610	-228

Wesentliche Verbundene / Assoziierte Unternehmen

Stand 30.09.00

	Eigenkapital	Ergebnis n. Steuern	Kapitalan teil
	in Tsd. EURO	in Tsd. EURO	In %
I. Verbundene Unternehmen			
1. Verbundene Unternehmen / Inland (Affiliated companies / Germany)			
eupec GmbH & Co. KG, Warstein-Belecke	38.594	10.319	100%
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden	155.460	56.156	100%
2. Verbundene Unternehmen / Ausland (Affiliated companies / International)			
<u>Europa</u>			
Infineon Technologies Holding B.V. Rotterdam, Niederlande	3.668.290	91.508	100%
Infineon Technologies-Fabrico de Semicondutores Portugal S.A., Villa do Conde, Portugal	67.560	22.168	100%
Infineon Technologies France S.A.S., Saint Denis, Frankreich	187.693	13.139	100%
Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich	666.618	613.218	100%
Infineon Technologies U.K. Ltd., Bracknell, Großbritannien	12.001	4.619	100%
<u>USA</u>			
Infineon Technologies Holding North America Inc., Wilmington, USA	332.851	7.266	100%
Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, USA	-63.634	8.696	100%
White Oak Semiconductor Limited Partnership, Richmond, USA	223.129	43.303	100%
<u>Asien</u>			
Infineon Technologies Asia Pasific Pte. Ltd., Singapore	210.113	66.129	100%
Infineon Technologies Integrated Circuits Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	85.957	32.691	100%
Infineon Technologies Malaysia Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	106.970	65.272	100%
Infineon Technologies Japan K.K., Tokyo, Japan	11.409	1.678	100%
II. Assoziierte Unternehmen			
1. Sonstige Beteiligungen / Inland (Associated and related companies / Germany)			
Freiberger Compound Materials GmbH, Freiberg	18.305	6.577	13%
OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG, Regensburg	33.305	13.916	49%
Semiconductor 300 GmbH & Co. KG, Dresden	15.340	57	50%
2. Sonstige Beteiligungen / Ausland (Associated and related companies / International)			
ALTIS Semiconductor S.N.C., Essonnes, Frankreich	365.497	11.282	50%
ProMOS Technologies Inc., Hsinchu, Taiwan	1.085.617	187.496	33%

Die Werte entsprechen den nach landesspezifischen Vorschriften aufgestellten Abschlüssen.

Die Umrechnung der Auslandswerte erfolgte für das Eigenkapital mit dem Mittelkurs zum Bilanzstichtag, für das Ergebnis mit dem Durchschnittskurs des Geschäftsjahres.

Kapitalflussrechnung in Mio. EURO

Geschäftsjahr 01.10.99 – 30.09.2000

		Vorjahr 01.04. – 30.09.99
Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag)	520	(81)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	228	110
Erhöhung der Rückstellungen	395	1
Ergebnis aus Anlageabgängen	(3)	(14)
Erhöhung der Vorräte	(67)	(3)
Erhöhung der Forderungen	(627)	(184)
Verminderung der Verbindlichkeiten	(167)	(339)
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	279	(510)
Sachanlageinvestitionen (einschl. immat. Vermögensgegenstände)	(543)	(134)
Finanzanlageinvestitionen	(634)	(178)
Konzernfinanzierung	(666)	0
Erlöse aus Anlagenabgängen	15	33
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	(1.828)	(279)
Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen an assoziierten Unternehmen	169	0
Erhöhung des Grundkapitals und der Kapitalrücklage	828	1.585
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	997	1.585
Veränderung der Liquidität	(552)	796
Liquidität, Stand 30.9.	244	796

**Der Vorstand
der Infineon Technologies AG**

Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30.09.2000)

Dr. Ulrich Schumacher

Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer

Vorsitzender des Board of Directors:

- Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore
- Infineon Technologies Japan K.K., Tokyo, Japan
- Infineon Technologies North America Corp., Wilmington Delaware, USA

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

- Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich

Externe Mandate:

Mitglied des Aufsichtsrates:

- Deutsche Bahn AG, Berlin

Peter Bauer

Mitglied des Vorstands und Chief Sales and Marketing Officer

Mitglied des Board of Directors:

- Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore
- Infineon Technologies Japan K.K., Tokyo, Japan
(Stellvertreter des Vorsitzenden)
- Infineon Technologies North America Corp., Wilmington Delaware, USA
- Infineon Technologies Savan Ltd., Netanya, Israel
- Infineon Technologies U.K. Ltd., Bracknell, Great Britain

Peter J. Fischl

Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer

Mitglied des Board of Directors:

- Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore
- Infineon Technologies Japan K.K., Tokyo, Japan
- Infineon Technologies North America Corp., Wilmington Delaware, USA

Mitglied des Aufsichtsrates:

- Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich

Mitglied des Vorstandes:

- Infineon Technologies Pension Trust e.V. München

Mitglied der Gesellschafterdelegation:

- Osram Opto Semiconductors, GmbH & Co. OHG, Regensburg

Dr. Sönke Mehrgardt

Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer

Dr. Andreas von Zitzewitz

Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer

Vorsitzender der Gesellschafterdelegation:

- Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG Dresden
- Eupec GmbH & Co. KG, Warstein-Belecke

Mitglied des Board of Directors:

- Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore
- White Oak Semiconductor Limited Partnership, Wilmington, Delaware, USA
- Infineon Technologies Fabrico de Semicondutores Portugal S.A., Vila do Condo, Portugal
- ProMOS Technologies Inc., Hsinchu, Taiwan

Präsident (in Vertretung der Infineon Technologies AG):

- Infineon Technologies France S.A.S., Saint-Denis, Frankreich
- Infineon Technologies Holding France S.A.S., Saint-Denis, Frankreich

Externe Mandate:

Mitglied des Aufsichtsrates

- Steag Hamatech AG, Sternenfels

**Der Aufsichtsrat
der Infineon Technologies AG**

Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30.09.2000)

Dr. Eng. h.c. Volker Jung
Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der Siemens AG

weitere Mandate

Aufsichtsrat

Direkt Anlage Bank AG, München

Epcos AG, München (Vorsitz)

MAN AG, München

Messe München GmbH, München

Konzernmandate

Siemens A.E., Athen, Griechenland (Vorsitzender des Verwaltungsrats)

Siemens Ltd., Johannesburg, RSA (stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats)

Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, München (Vorsitzender des Beirats)

Siemens Information and Communication Networks, Inc., Boca Raton, Florida, USA (Member of the Board)

Alfred Eibl *
stellv. Vorsitzender

Mitglied des Betriebsrats, Betrieb München Balan-/St.-Martin-Straße

Dr. h.c. Martin Kohlhaussen
stellv. Vorsitzender
(seit 1. November 1999)

Sprecher des Vorstands der Commerzbank AG

weitere Mandate

Aufsichtsrat

Bayer AG, Leverkusen

Bertelsmann AG, Gütersloh

Hereaus Holding GmbH, Hanau

Hochtief AG, Essen

KarstadtQuelle AG, Essen

Schering AG, Berlin

Linde AG, Frankfurt am Main

Konzernmandate

RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank AG, Frankfurt am Main
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Commerzbank International S.A. (CISAL), Luxemburg (Vorsitzender
des Verwaltungsrats)

Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz (Präsident des
Verwaltungsrats)

Commerzbank (South East Asia) Ltd., Singapur (Chairman of the
Board of Directors – non executive)

externe Mandate

Assicurazioni Generali S.P.A., Triest, Italien (Verwaltungsrat)

DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Shareholder Committee)

Ender Beyhan *

Mitglied des Betriebsrats, Betrieb München Perlach

Johann Dechant *

Mitglied des Betriebsrats, Betrieb Regensburg West

Dr. Joachim Faber
(seit 01.11.1999)

Mitglied des Vorstands der Allianz AG

weitere Mandate

Aufsichtsrat

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Frankfurt am Main
Berliner Wasser AG, Berlin
Lloyd Adriatico S.p.A., Triest, Italien
Societa Metallurgica Italiana S.p.A., Florenz, Italien
Mercur Assistance AG Holding, München
Karlsruher Rendite GmbH, Karlsruhe

Konzernmandate

Allianz Vermögensbank, Augsburg (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Universal-Leasing-GmbH, München
(stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Allianz Asset Management GmbH, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Allianz Capital Partners, München (Aufsichtsrat)
Allianz Risk Transfer, Zürich, Schweiz (stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats)
IRC International Reinsurance Company S.A., Luxemburg (Verwaltungsrat)
RASBANK S.p.A., Mailand, Italien (Verwaltungsrat)

Heinz Hawreliuk *

Leiter der Abteilung Unternehmensmitbestimmung der IG Metall

weitere Mandate

Aufsichtsrat

Siemens AG, München
DaimlerChrysler Aerospace AG, München
DaimlerChrysler Luft- und Raumfahrt Holding AG, München
Eurocopter Deutschland GmbH, Donauwörth
Spezialtechnik Dresden GmbH, Dresden

Charles Herlinger
(bis 31.10.1999)

Leiter der Hauptabteilung Bilanzierung, Controlling und Steuern der Siemens AG

Klaus Luschtinetz *

Vorsitzender des Betriebsrats, Betrieb München Balan-/St.-Martin-Straße

weitere Mandate

Siemens Betriebskrankenkasse, München (Verwaltungsrat)

Karl-Heinz Midunsky
(bis 31.10.1999)

Leiter der Hauptabteilung Finanzierung, Gesellschaften und
Versicherungen der Siemens AG

weitere Mandate

Aufsichtsrat
Gerling Speziale KreditversicherungsAG, Köln
Hannover Rückversicherungs-AG, Hannover

Konzernmandate
RISICOM Rückversicherung AG, Grünwald (Vorsitzender des
Aufsichtsrats)
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn (Vorsitzender
des Aufsichtsrats)
Siemens Financial Services, München (Aufsichtsrat)
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH, München (Aufsichtsrat)
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München
(Aufsichtsrat)
OSRAM GmbH, München (Aufsichtsrat)
Siemens Building Technologies, Zürich, Schweiz (Verwaltungsrat)

Prof. Dr. rer.pol. Michael Mirow
(bis 31.10.1999)

Leiter der Hauptabteilung Unternehmensstrategie der Siemens AG

Heinz-Joachim Neubürger

Mitglied des Vorstands der Siemens AG

weitere Mandate

Aufsichtsrat
Allianz Versicherungs-AG, München
Bayerische Handelsbank AG, München

Konzernmandate
Siemens Financial Services GmbH, München (Vorsitzender des
Aufsichtsrats)
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH, München (Vorsitzender
des Aufsichtsrats)
TELA Versicherungs AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Siemens Corporation, New York, USA (Vice Chairman of the Board
of Directors)
Siemens Immobilien Management GmbH & Co. OHG, München
(Vorsitzender des Beirats)
Siemens Ltd. China (SLC), Beijing, VR China (Member of the Board)
Siemens Western Finance N.V., Willemstad/Curacao (Managing
Director)

Stefan Radloff *

Senior Vice President, Accounting and Financial Reporting der
Infineon Technologies AG

Dr. Eberhard Rauch
(seit 01.11.1999)

Mitglied des Vorstands der Hypo- und Vereinsbank AG

weitere Mandate

Aufsichtsrat
Kennametal Hertel AG, Fürth (Vorsitz)
Koenig & Bauer AG, Würzburg

Konzernmandate
DAB Direkt Anlage Bank GmbH, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Norisbank AG, Nürnberg (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Planet Home AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Bank Przemyslowo-Handlowy SA, Krakau, Polen (Aufsichtsrat)
Vereinsbank Victoria Bauspar AG, München (Aufsichtsrat)
HVB Informations-Verarbeitungs-GmbH, München (Vorsitzender des Verwaltungsrats)

externe Mandate

Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH, Bamberg (Verwaltungsrat)
Clearstream International S.A., Luxemburg (Member of the Board of Directors)

Univ.-Prof. Dr.- Ing. Ingolf Ruge
(seit 01.11.1999)

Ordinarius
Technische Universität München

weitere Mandate

Aufsichtsrat
Schneider Technologies AG, Türkheim

Dr. jur. Albrecht E.H. Schäfer
(bis 31.10.1999)

Justitiar der Siemens AG

weitere Mandate

Aufsichtsrat
Epcos AG, München

Konzernmandate
RISICOM Rückversicherung AG, Grünwald (Aufsichtsrat)
Siemens Financial Services GmbH, München (Aufsichtsrat)
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn (Aufsichtsrat)

Gerd Schmidt *

Vorsitzender des Betriebsrats, Betrieb Regensburg West

Sibylle Wankel *

Tarifabteilung der IG Metall, Bezirksleitung Bayern

weitere Mandate

Aufsichtsrat
Compaq Computer GmbH, Dornach

Prof. Dr. phil. Claus Weyrich

Mitglied des Vorstands der Siemens AG

weitere Mandate

Konzernmandate

Siemens Corporate Research, Princeton/USA (Chairman of the Board)

Siemens Venture Capital GmbH, München (Board Member)

Dr.-Ing. Klaus Wucherer

Mitglied des Vorstands der Siemens AG

weitere Mandate

Konzernmandate

Eviop-Tempo, Griechenland (Verwaltungsrat)

Siemens France S.A., Frankreich (Verwaltungsrat)

Simko Ticaret, Türkei (Verwaltungsrat)

Siemens Ltd., China (Vorsitzender des Verwaltungsrat)

Siemens E&A, USA (Vorsitzender des Verwaltungsrats)

Yaskawa Siemens Automation & Drives/YSAD, Japan (Vorsitzender des Verwaltungsrats)

* Arbeitnehmersvertreter

München, den 13. Dezember 2000

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

Dr. Ulrich Schumacher

Peter Bauer

Peter Fischl

Dr. Sönke Mehrgardt

Dr. Andreas v. Zitzewitz

Lagebericht und Konzernlagebericht der Infineon Technologies AG für das Geschäftsjahr 2000 vom 1. Oktober 1999 bis zum 30. September 2000

Dieser zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht (Lagebericht) enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Infineon beruhen, die verbunden sind mit der erwarteten künftigen Entwicklung des Halbleitermarktes, der relativen Marktposition und der technologischen und produktionstechnischen Leistungsfähigkeit von Infineon, den erwarteten Erfolgen aus der Forschung und Entwicklung sowie aus Kooperationen, den geplanten Investitionen in den weiteren Ausbau und die Modernisierung der Produktionskapazitäten sowie die weitere Reduzierung der Chipstrukturen und die Einführung einer neuen Fertigungstechnologie in Dresden bzw. den dadurch erwarteten Kosteneinsparungen. Obwohl der Vorstand annimmt, dass die den Prognosen zugrundeliegenden Erwartungen realistisch sind, kann er nicht dafür garantieren, dass diese Erwartungen sich auch als richtig erweisen werden. Die Annahmen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen abweichen.

Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören künftige Veränderungen im weltwirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld wie auch Nachfrage-, Preis-, Wechselkurs- und Zinsschwankungen. Besonderen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung von Infineon können folgende Faktoren haben: die Einführung von Konkurrenzprodukten, Änderungen der Geschäftsstrategie von Wettbewerbern und Kunden, die erfolgreiche Entwicklung und Einführung marktfähiger Produkte sowie neuer Produktionsprozesse durch Infineon und eine mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen am Halbleitermarkt. Ebenso werden die Prognosen beeinflusst durch die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln für den angestrebten gezielten Ausbau des Unternehmens und dessen Fähigkeit, die Wachstumsziele zu erreichen, um die Entwicklung der finanziellen Ergebnisse von Infineon im Geschäftsjahr 2001 fortzusetzen. Eine Aktualisierung der Prognosen durch Infineon ist weder geplant noch übernimmt die Gesellschaft die Verpflichtung dazu.

Grafiken und Schaubilder dienen der Veranschaulichung und sind nicht Teil dieses Lageberichts.

Die Infineon Technologies AG ist die Führungsgesellschaft des Konzerns mit entsprechenden Leitungs- und Zentralfunktionen. Sie übernimmt wesentliche übergreifende Aufgaben wie das konzernweite Finanz- und Rechnungswesen, die Personalwirtschaft, strategische und produktionsorientierte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die weltweite Unternehmens- und Marketingkommunikation und steuert die logistischen Prozesse im Konzern. Die Gesellschaft verfügt über eigene Fertigungen in Berlin, München und Regensburg.

Die Gesellschaft ist in eine konzernweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsstruktur eingebunden, die Abrechnung konzerninterner Lieferungen und Leistungen der produzierenden und vertreibenden Tochtergesellschaften erfolgt über die Infineon Technologies AG. Aus diesen Gründen ist der Lagebericht der Infineon Technologies AG mit dem des Infineon-Konzerns zusammengefasst.

Der Konzernabschluss der Infineon Technologies AG wurde nach § 292a HGB (Handelsgesetzbuch) unter Anwendung der US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) Rechnungslegungsgrundsätze aufgestellt. Die US GAAP sind Bilanzierungsvorschriften für Unternehmen, deren Aktien an amerikanischen Börsen gehandelt werden. Damit können neben Investoren vor allem Analysten und Journalisten, aber auch Kunden und Lieferanten die Geschäftsentwicklung von Infineon besser mit der Entwicklung von fast allen bedeutenden internationalen Wettbewerbern vergleichen, die überwiegend nach US GAAP bilanzieren.

Erfolgreicher Börsengang und Rekordergebnisse

Das Geschäftsjahr 2000 war für Infineon geprägt durch eine weit über dem Marktwachstum liegende Ausweitung des Geschäftsvolumens und eine eindrucksvolle Steigerung der Rentabilität. Gleichzeitig stellte das Unternehmen weitere Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Insbesondere wurden die Forschung und Entwicklung intensiviert, Produktionskapazitäten erweitert sowie die Vertriebsaktivitäten gestärkt. Im Mai 2000 wurde in Dresden der Grundstein gelegt für die weltweit erste Fabrik, in der ab dem Geschäftsjahr 2002 Chips auf 300-Millimeter-Siliziumscheiben gefertigt werden sollen. Damit glaubt

Infineon seine technologisch führende Position weiter ausbauen und sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern zu können.

Fast ein Jahr nach der Ausgliederung des Siemens-Halbleiterbereichs wurden die Aktien der Infineon Technologies AG am 13. März 2000 erstmals im Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und als American Depositary Shares (ADS) an der New York Stock Exchange notiert. Die Kursentwicklung der ersten Monate trug dazu bei, dass Infineon am 19. Juni 2000 in den Kreis der DAX 30-Unternehmen, in den Index FTSE Eurotop 300 sowie in Einzelsegmente der Index-Familie DJ (Euro) STOXX aufgenommen wurde.

Durch den Börsengang verfügt die Gesellschaft über zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten sowie eine Akquisitionswährung insbesondere auch in den USA.

Als alleiniger Altaktionär platzierte Siemens 156,8 Millionen Aktien. Infineon flossen infolge einer Kapitalerhöhung mit der Ausgabe von 16,7 Millionen Aktien sowie einer Privatplatzierung von 7,6 Millionen Aktien bei Intel insgesamt 821 Mio. Euro zu. Der Anteil von Siemens am Grundkapital verringerte sich damit auf 71 Prozent. Siemens hat ferner eine garantierte Umtauschanleihe (Exchangeable Note) auf vier Prozent der Infineon-Aktien ausgegeben und im August 2000 an der Luxemburger Börse platziert. Die fest verzinslichen Wertpapiere haben eine Laufzeit bis zum August 2005. Die Inhaber der Anleihe können diese erstmals im August 2001 in insgesamt 25.000.000 Infineon-Aktien umtauschen.

Infineon wächst schneller als der Markt

Der Halbleitermarkt zeigte im Geschäftsjahr 2000 in allen wichtigen Segmenten ein starkes Wachstum. Insgesamt überstieg die Nachfrage nach Chipwendungen in nahezu allen Marktsegmenten die weltweit vorhandenen Fertigungskapazitäten der Halbleiterhersteller.

Für das Kalenderjahr 2000 erwartet das Marktforschungsinstitut Gartner Dataquest ein Gesamtwachstum der Halbleiterumsätze von 37 Prozent auf 232 Mrd. US-Dollar (Stand: Oktober 2000). Der Markt bei Nicht-Speicherchips - Logikchips, analogen, diskreten und optischen Komponenten - soll demnach um 30 Prozent wachsen. Die Gesamtumsätze im Speicherchip-Markt, welcher DRAMs und Flash Memories (nichtflüchtige Speicher) umfasst und etwa einem Viertel des Gesamtmarktes entspricht, sollen demzufolge sogar um 60 Prozent steigen.

Geografisch gesehen erwartet Gartner Dataquest das größte Wachstum mit mehr als 40 Prozent in der Region Asien/Pazifik. Der amerikanische Chipmarkt wächst im Jahr 2000 voraussichtlich um 38 Prozent, der japanische um 35 Prozent. Für Europa wird ein Gesamtwachstum von 34 Prozent erwartet.

Umsatz um 72 Prozent gesteigert

Im Berichtsjahr konnte Infineon den Umsatz um rund 72 Prozent auf 7.283 Mio. Euro steigern (Vorjahr: 4.237 Mio. Euro). Auf Grund des schwachen Euro konnte Infineon positive Wechselkurseffekte realisieren. Ohne diese Effekte beläuft sich das Umsatzwachstum von Infineon auf 60 Prozent. Bereits nach Abschluss der ersten drei Quartale hatte Infineon den Umsatz des Vorjahres um 666 Mio. Euro übertroffen. Im letzten Quartal des Berichtsjahres wurde mit einem Quartalsumsatz von 2.380 Mio. Euro ein neuer Rekord erzielt.

Insgesamt trugen alle Geschäftsbereiche zum starken Wachstum bei. Der Bereich Speicherprodukte dominierte mit einem Plus von 147 Prozent; hauptsächlicher Wachstumstreiber waren dabei die durch signifikante Produktivitätssteigerungen erhöhten Kapazitäten sowie die hervorragende Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise am Markt für Speicherchips.

Der Konzern hat seine Position als einer der zehn größten Halbleiterhersteller der Welt gefestigt. Vor allem in zwei Regionen wurden die Umsätze deutlich gesteigert: im Raum Asien/Pazifik um 134 Prozent auf 2.100 Mio. Euro (Vorjahr: 899 Mio. Euro) sowie in den USA um 119 Prozent auf 1.814 Mio. Euro (Vorjahr: 827 Mio. Euro).

Auftragsreichweite erreicht Rekordniveau

Die Halbleiterindustrie ist - im Gegensatz zum Anlagenbau - speziell im Massenmarkt geprägt von geringen Auftragsreichweiten, die sich derzeit insbesondere aufgrund der über dem Angebot liegenden Nachfrage erhöhen. Vor diesem Hintergrund zeigten im Geschäftsjahr 2000 nahezu alle Bereiche von Infineon bei Auftragseingang und Auftragsbestand einen deutlichen Anstieg. Ende September 2000 wurde eine Auftragsreichweite von durchschnittlich 3,6 Monaten ermittelt (Vorjahr: 2,9 Monate) und von 5 bis 6 Monaten bei einigen Kommunikationssegmenten.

Im günstigen Marktumfeld hat Infineon seine positive Umsatz- und Auftragsentwicklung erreicht durch:

- eine verstärkte Fokussierung auf die weniger volatilen Wachstumssegmente Kommunikationssysteme und High-end DRAMs
- den Ausbau der weltweiten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
- das Verkürzen der Zeitspannen von der Produktentwicklung bis zur Markteinführung
- die weitere Erhöhung der Fertigungskapazitäten und die nochmalige Steigerung der Produktivität sowie
- die Einstellung neuer Mitarbeiter in allen Bereichen und Regionen

Forschung und Entwicklung weltweit intensiviert

Das Innovationstempo der Halbleiterbranche ist außerordentlich hoch. Durch seine verstärkte strategische Forschung sowie gezielte operative Entwicklungsaktivitäten in Zusammenarbeit mit Kunden, setzt Infineon Maßstäbe und bestimmt den Fortschritt der Elektronikindustrie entscheidend mit. Dabei werden insbesondere strategische Projekte kooperativ mit anderen Chipherstellern sowie mit Partnern aus anderen Technologiebereichen durchgeführt. Wesentliche Vorteile derartiger Partnerschaften sind das Teilen von Entwicklungskosten, das geringere Risiko von Fehlentwicklungen sowie die schnellere Verfügbarkeit neuer Technologien am Markt.

Von den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Höhe von 1.025 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2000 floss der größte Anteil in die Entwicklung profitabler Produkte. Daneben entwickelte Infineon seine Produktionstechnologien für Halbleiter und sein Portfolio an universell einsetzbaren Prozessormodulen weiter. Außerdem wurde die Montagetechnologie optimiert und der Automatisierungsgrad der Entwicklungsumgebung erhöht, die den Chip-Entwurfsprozess effizienter macht.

Sechs neue Entwicklungszentren aufgebaut

Infineon erweitert immer wieder sein internationales Netzwerk von aktuell 27 Entwicklungszentren an Standorten, an denen hervorragende Ingenieurteams mit Spezialkenntnissen verfügbar sind und für das Unternehmen gewonnen werden können. Im Berichtsjahr kamen sechs Standorte neu hinzu: Aalborg in Dänemark, Durham in den USA, Linz in Österreich, Nashua in den USA, Nürnberg in Deutschland und Tel Aviv in Israel. Ein weiteres wurde im November 2000 bei Grenoble in Frankreich eröffnet. Am 30. September 2000 arbeiteten im Konsolidierungskreis weltweit über 4.700 Spezialisten in der Forschung und Entwicklung.

Bestand an Patenten und sonstigen Schutzrechten wächst weiter

Im Zuge der Gründung erhielt Infineon von Siemens eine hohe Zahl von Schutzrechten und dabei insbesondere mehr als 25.000 Patente. Im Laufe des Berichtsjahres ist der Bestand an Schutzrechten stark angestiegen: Infineon verfügte am Ende des Geschäftsjahres 2000 über mehr als 28.200 Patente und Patentanmeldungen in fast 100 Ländern. Sie bilden zusammen 5.250 Patentfamilien (Vorjahr: 4.210). Darüber hinaus haben Infineon und Siemens einen begrenzten gegenseitigen Zugriff auf ihr geistiges Eigentum vereinbart.

Weltmarktführerschaft bei System-on-Chip ausgebaut

Die Entwicklungsteams von Infineon konzentrierten sich im Berichtsjahr einerseits auf komplexe System-on-Chip-Lösungen und damit auf Produkte, die für weniger volatile Wachstumsmärkte wie Mobilfunk, Breitbandkommunikation, Sicherheits- und Automobiltechnik bestimmt sind. Andererseits wurde die High-end Produktpalette für den Speicherchip-Markt mit Produkten für anspruchsvolle PCs und Notebooks sowie für Internet-Server ausgebaut.

Mobile Kommunikation

Seine führende Rolle als Lieferant für die mobile Kommunikationswelt bestätigte Infineon im Berichtsjahr mit der Markteinführung mehrerer Produkte:

- Als weltweit erster Hersteller brachte Infineon zwei Einchip-GSM-Lösungen für GPRS-Dienste auf den Markt, einen Basisband-Logikchip (E-GOLD+) und einen Hochfrequenz-Transceiver (SMARTi+). Die beiden Produkte wurden für den Einsatz in leistungsfähigen - kleineren, leichteren und kostengünstigeren - Internet-Mobiltelefonen entwickelt. Zusammen ermöglichen sie Datenraten von bis zu 107 Kilobit in der Sekunde, was etwa dem zehnfachen Datendurchsatz bisheriger Lösungen entspricht.
- Mit dem M-GOLD-Chip stellte die Gesellschaft den weltweit ersten Basisband-Einzel-Chip für Dualmode-UMTS/GSM-Mobiltelefone vor. Er ermöglicht Herstellern und Nutzern, die gleichen Endgeräte sowohl in den aktuellen GSM-/GPRS-Netzen als auch in den späteren UMTS-Netzen einzusetzen. Gleichzeitig ist er ein wichtiger Türöffner bei potenziellen Kunden, die jetzt neue UMTS-Mobiltelefone für die Zeit ab dem Jahr 2002 entwickeln. Eine komplette UMTS-Systemlösung inklusive Hochfrequenz-Chipset soll im neuen Geschäftsjahr vorgestellt werden. Der Hochfrequenz-Teil soll bereits im Jahr 2001 im japanischen W-CDMA-Markt zum Einsatz kommen.
- "BlueMoon I" ist der Name des ersten Chipsatzes von Infineon für den Bluetooth-Standard, der künftig Mobiltelefone, Computer, Drucker, Kopfhörer, Persönliche Digitale Assistenten, Set-Top-Boxen und andere elektronische Geräte schnurlos miteinander verbinden soll. Diese erste am Markt verfügbare Zweichip-Systemlösung - bestehend aus einem Basisband-Chip und einem Hochfrequenz-Transceiver - wird von Infineon auch mit der Software für komplette Bluetooth-Module geliefert. Damit baut Infineon seine technologische Spitzenstellung bei Chipsystemen für schnurlose Anwendungen im Haus- und Bürobereich weiter aus, die auf bisher mehr als 30 Millionen produzierten Transceivern für schnurlose DECT-Telefone und WDCT-Systeme beruht.

Drahtgebundene Kommunikation

Im Geschäftsjahr 2000 konzentrierte sich der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation verstärkt auf Anwendungen für den schnell wachsenden Markt für Internet-Infrastruktur:

- Mit der Akquisition der israelischen Firma Savan Communications wurde Infineon Marktführer in der VDSL-Technologie. Die VDSL-Zweichip-Lösung, die beide Unternehmen zusammen entwickelt hatten, ermöglicht Datenraten von bis zu 26 Megabit pro Sekunde über ein einziges Kupferkabel für Breitband-Dienste wie zum Beispiel interaktives Fernsehen, Video-Spiele und hochauflösende Video-Konferenzen.
- Als Reaktion auf den explosionsartig steigenden Bedarf an höheren Bandbreiten stellte Infineon im Juni 2000 den kompakten Chipsatz "10BaseS" vor. Er unterstützt den Ethernet-Datentransfer über Entfernungen von mehr als 1,2 Kilometern mit hundertfacher ISDN-Geschwindigkeit. Der Chipsatz kann beispielsweise in Hotels, Universitäten sowie Geschäfts- und Industriegebäuden eingesetzt werden, die schnell und günstig zuverlässigere Kommunikationsnetzwerke über bestehende PBX- oder Telefonleitungen aufbauen wollen.
- Ebenfalls für die Breitband-Kommunikation über Kupferkabel wurde im Berichtsjahr der Einkanal-SHDSL-Transceiver Sokrates entwickelt. Mit dieser Einchip-Lösung können Service-Provider auf existierenden Kupferdrähten nahezu das Leistungsniveau einer Standleitung anbieten. Sokrates unterstützt Bitraten von 160 bis 2360 Kilobit pro Sekunde und ist kompatibel zum konventionellen Telefondienst sowie zu ISDN- und xDSL-Diensten.

- Für optische Netzwerke hat Infineon im Berichtsjahr die Produktfamilie PAROLI (Parallel Optical Link) eingeführt, eine Technologie für parallele optische Hochgeschwindigkeits-Verbindungen via Breitband-Datenübertragung. Die Produktfamilie umfasst eine Reihe von AC-(Asynchronous) und DC-(Synchronous) Send- und Empfangsmodulen für die parallele Datenübertragung über Lichtwellenleiter. Im August 2000 wurde die PAROLI-Technologie an die Firma Molex, Inc. lizenziert, um im Markt für Glasfaserkabel noch schneller wachsen zu können.

Sicherheits- und Chipkarten ICs

Der Geschäftsbereich hat im Berichtsjahr sein internationales Entwicklungsnetzwerk mit Softwareprojekten in Indien sowie Design-Projekten in Österreich weiter ausgebaut.

- Insbesondere in punkto Sicherheit von Chipkarten-Controllern hat Infineon als Weltmarktführer für Chipkarten-Chips auch seine Technologieführerschaft verteidigt: Bereits zum dritten Mal hat ein Chip von Infineon die derzeit weltweit strengste Sicherheitsevaluierung für Bauelemente in Chipkarten erfolgreich bestanden. Eine derartige Zertifizierung ist zum Beispiel nach dem deutschen Gesetz über die digitale Signatur (SigG) gefordert. Nach den vorliegenden Informationen hat bisher kein Wettbewerber seine Produkte auf einem vergleichbar hohen Niveau prüfen lassen.
- Die 16-Bit-Chipkarten-Controller der 66Plus-Familie werden nun in der für Chipkarten-ICs modernsten 0,25-Mikrometer-Prozesstechnologie gefertigt. Dieser Technologievorsprung ermöglichte es Infineon, den ersten am Markt verfügbaren Chipkarten-Sicherheitscontroller mit einer Speichergröße von 64 Kilobyte EEPROM herzustellen. Aufgrund des größeren Speicherplatzes können bei modernsten Kartenanwendungen in GSM-Handys sowie im Banksektor von den Serviceanbietern neue Applikationen wie zum Beispiel WAP oder Zahlungsvorgänge über das Mobiltelefon zur Verfügung gestellt werden.

Speicherprodukte

Der Geschäftsbereich Speicherprodukte hat im Berichtsjahr seine Technologieführerschaft bei der Entwicklung von DRAMs bestätigt. Dabei wurde in diesem Bereich das Intellectual Property mit einer stark erhöhten Anzahl von Patentanmeldungen erheblich ausgeweitet.

- Anfang 2000 hat der Bereich seine 0,17-Mikrometer-Prozesstechnologie qualifiziert, die noch in 2000 an allen DRAM-Standorten zur Produktion modernster 128- und 256-Megabit-Speicherchips hochgefahren wurde. Der Infineon-Prozess gilt als fortschrittlichste Technologie weltweit und ermöglicht die Produktion kleinster und damit kostengünstigster Chipgrößen, die Wettbewerber erst mit ihren 0,15-Mikrometer-Technologien erreichen werden.
- Bereits im April 2000 konnte Infineon als eines der ersten Unternehmen Muster seiner 256-Megabit-Double-Data-Rate (DDR)-Synchronous-DRAM (SDRAMs)-Chipserie ausliefern. Damit ist das Unternehmen bestens für den Schritt in Richtung DDR-Standard gerüstet, den die Industrie noch in 2000 vollzieht. Die DDR-Technologie bietet Preis-Leistungsvorteile bei Servern, Workstations und leistungsfähigen Desktop-PCs.
- Um dauerhaft das hohe Tempo der Industrie beim Verkleinern der Chipstrukturen halten zu können, hat Infineon zusammen mit IBM eine zukunftsweisende Technologie entwickelt, die die bestehenden Grenzen des planaren Transistors in der Speicherzelle überwindet: die vertikale Transistorzelle.

Automobil- und Industrieelektronik

- Mit den Produktlinien HITFET[®], PROFET[®] und OptiMOS[™] gelang es Infineon, die Technologieführerschaft bei Power Switches zu übernehmen und in den wichtigen japanischen Markt einzutreten. Die Komponenten schalten und schützen bei vielen Fahrzeugen Elektromotoren, Scheinwerfer und andere elektrische Komponenten. Darüber hinaus unterstützen sie das elektronische Motormanagement und Sicherheitsanwendungen wie ABS und Airbag. Für die Power Switch-Technologie wurde Infineon auf dem SAE Weltkongress in Detroit (USA) mit dem Tech 2000-Preis des Fachmagazins „Automotive Engineering International“ für das innovativste Produkt ausgezeichnet.
- Im Juni stellte Infineon bereits mit CoolMOS[™]-C2 eine zweite Generation von Power-Transistoren vor, die sich neben sehr geringen Leistungsverlusten zusätzlich durch wesentlich reduzierte Schaltverluste auszeichnet.
- Von der High-end 32-bit Mikrocontroller-Familie TriCore[™] präsentierte Infineon als wesentliche Komponente einen neuen Chip, dessen Architektur konsequent auf zukünftige „Automotive Embedded Control“-Systeme ausgerichtet ist. Erste Muster wurden bereits an führende Schlüsselkunden ausgeliefert, die nun ihre eigenen Produkte mit Systemchips von Infineon entwickeln. Weitere auf dem TriCore-Prozessor basierende Chips werden nun entwickelt.

Prozesstechnologie: Chipstrukturen verkleinert

In der Halbleiter-Prozesstechnologie arbeitet Infineon intensiv an der weiteren Verkleinerung der Silizium-Chipstrukturen. Dadurch können einerseits mehr Transistoren auf der gleichen Chipfläche untergebracht werden, andererseits lässt sich ihre Schaltgeschwindigkeit erhöhen. Die größere Leistungsfähigkeit auf kleinerer Chipfläche erlaubt einen höheren Integrationsgrad und ermöglicht es den Kunden, günstigere Systemlösungen zu entwickeln.

Kooperationen: Wettbewerbsposition gestärkt

Seit Januar 2000 entwickelt Infineon zusammen mit seinen Partnern IBM und UMC (United Microelectronics Corporation) die nächste Technologiegeneration für Strukturgrößen von 0,13 und später 0,10 Mikrometern. So lassen sich Chips mit höheren Schaltgeschwindigkeiten und besonders niedrigem Energieverbrauch herstellen, die vor allem in akkubetriebenen Geräten wie Mobiltelefonen und Notebooks eingesetzt werden können.

Im März 2000 vergab das Unternehmen weitere Lizenzen an das gemeinsam mit Mosel Vitelic geführte Gemeinschaftsunternehmen ProMOS Technologies. Auf Basis der von Infineon entwickelten 0,17-Mikrometer-Technologie bzw. den in der Entwicklung befindlichen 0,14-Mikrometer- und 0,12-Mikrometer-Technologien produziert ProMOS DRAMs, die über die Vertriebskanäle von Infineon und Mosel Vitelic verkauft werden. Darüber hinaus haben Infineon und ProMOS im April vereinbart, dass ProMOS die 300-Millimeter-Technologie ebenfalls ab dem Geschäftsjahr 2002 am bestehenden Standort Hsinchu einsetzen wird.

Um künftig mit Hilfe der sogenannten Next Generation Lithography (NGL) noch kleinere Chipstrukturen produzieren zu können, ist Infineon am europäischen MEDEA-Projekt "Ion Projection Lithography" beteiligt. Im Mai 2000 verstärkte die Gesellschaft diese Aktivitäten mit dem Beitritt zum amerikanischen EUV-LLC-Konsortium (Extreme Ultraviolet Limited Liability Corporation), dem außerdem AMD (Advanced Micro Devices), Intel und Motorola angehören.

Darüber hinaus hat Infineon mit fünf weiteren führenden Halbleiterproduzenten - Hyundai Electronics, Intel Corporation, Micron Technologies, NEC Corporation und Samsung Electronics - die Zusammenarbeit bei Architektur, Design und Struktur der sogenannten "Advanced DRAM"-Technologie vereinbart. Diese Technologie zielt auf potenzielle Anwendungen ab dem Jahr 2003.

Investitionen mehr als verdoppelt

Mit insgesamt 1.571 Mio. Euro erhöhte Infineon die Investitionen in Sachanlagen um 141 Prozent (Vorjahr: 653 Mio. Euro). Dies entspricht einer Investitionsquote vom Umsatz in Höhe von 22 Prozent. Die Mittel flossen vor allem in den Kapazitätsausbau für Logikprodukte der bestehenden Frontend-Fabriken in Dresden, Regensburg, Richmond und Villach.

Darüber hinaus investierte der Konzern 303 Mio. Euro in Beteiligungen (Vorjahr: 133 Mio. Euro). So erwarb Infineon vom bisherigen Partner Motorola dessen Anteile an White Oak Semiconductors in Richmond, den Geschäftsbetrieb von Savan Technologies in Tel Aviv sowie vom debis Systemhaus die Aktivitäten im Bereich Software für Mobilfunkgeräte in Nürnberg. Das Portfolio des Wagniskapital-Bereichs "Infineon Ventures" wurde im Berichtsjahr mit einem Investitionsvolumen von 38 Mio. Euro um 11 auf 21 Beteiligungen erweitert.

Weiterhin nahm der Konzern an einer Kapitalerhöhung bei ALTIS Semiconductor S.N.C. teil. ALTIS - ein Gemeinschaftsunternehmen von IBM und Infineon - hat mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsengangs seine Fertigungskapazität am Standort Essonnes ausgebaut.

Hohe Anforderungen an den Einkauf

Das gesamte Einkaufsvolumen von Infineon einschließlich Sachinvestitionen stieg im Berichtsjahr aufgrund der hervorragenden Auftragsentwicklung um 88 Prozent auf 3.413 Mio. Euro (Vorjahr: 1.820 Mio. Euro).

Aufgrund des weltweit starken Ausbaus der kapitalintensiven Fertigungen kommt insbesondere in einer Boomphase dem Einkauf eine herausragende Bedeutung zu. Die Vollausslastung der Halbleiterfabriken führte im Geschäftsjahr zu verlängerten Lieferzeiten, die insbesondere bei Anlagen für die Lithografie kritisch waren. Außerdem führte sie zu einer Verknappung und Verteuerung der Siliziumscheiben. Infineon löste die Situation weitgehend dank langfristiger Vereinbarungen und Kooperationen mit Schlüssellieferanten.

Um der Kundennachfrage und damit dem Bedarf an Fertigungskapazitäten stärker gerecht zu werden, wurde im Berichtsjahr das Einkaufsvolumen bei Auftragsfertigern (Silicon Foundries) um 140 Prozent auf 430 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 181 Mio. Euro).

Ausbau der Fertigungskapazitäten

Als Reaktion auf die außerordentlich gute Marktlage hat Infineon seine bestehenden Fertigungsstandorte ausgebaut und die Fertigungsprozesse weiter optimiert. Darüber hinaus wurde in Dresden der Grundstein zum Bau des weltweit ersten 300-Millimeter-Fertigungsmoduls gelegt. Diese Fertigung soll, verglichen mit der 200-Millimeter-Technologie, ab dem Geschäftsjahr 2002 bei DRAM-Produkten zu einem erheblichen Kostenvorteil führen. Die Technologieführerschaft von Infineon wurde von der Fachzeitschrift „Semiconductor International“ mit der Verleihung des Titels "Fabrik des Jahres 1999" für die bestehende 300-Millimeter-Pilotlinie in Dresden bestätigt.

Infineon rüstete im Geschäftsjahr 2000 einen Großteil der Speicherchip-Fertigung an den Standorten in Dresden, Richmond und Hsinchu (ProMOS) auf die neuen 0,19- und 0,17-Mikrometer-Technologien um. Außerdem fertigte ALTIS in Essonnes erstmals Hochleistungs-Logik-ICs mit 0,18 Mikrometern Strukturbreite für Anwendungen in der drahtlosen sowie der drahtgebundenen Kommunikation.

Um den hohen Bedarf an Produkten in Spezialtechnologien nachzukommen, wurde mit der Umstellung der Fertigungen in Regensburg und Villach auf die 200-Millimeter-Technologie begonnen. Entsprechend den höheren Frontend-Kapazitäten wurden auch die Backend-Fabriken für das Montieren und Testen von Chips in Malaysia, Singapur und Porto ausgebaut.

Direktvertrieb auf 300 Kunden fokussiert

Im Zuge der Ausgliederung aus der Siemens AG hat Infineon seinen Vertrieb reorganisiert. Der Direktvertrieb fokussiert sich auf rund 300 Kunden. Um die hohe Zahl weiterer Kunden ebenfalls individuell und effektiv zu bedienen, wickelt Infineon das Geschäft mit diesen Kunden über ein weltweites Netzwerk von Distributionspartnern ab. Derzeit wird außerdem eine elektronische Kundenbeziehungs-Plattform im Internet aufgebaut.

Im Rahmen des Aufbaus einer weltweiten Vertriebsorganisation übernahm Infineon eine große Zahl von Mitarbeitern von den Siemens-Landesgesellschaften. Damit verfügt Infineon jetzt in allen bedeutenden Märkten über eigene Vertriebsorganisationen, die bereits im Berichtsjahr 89 Prozent der Umsätze erzielten (Vorjahr: 79 Prozent). Insgesamt beschäftigte der Konzern am Ende des Geschäftsjahres rund 2000 Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing.

Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt

Der Konzern hat im Berichtsjahr die Belegschaft erneut ausgebaut und somit erheblich in sein wichtigstes Kapital investiert. Die Zahl der Mitarbeiter stieg zum Ende des Berichtsjahres um 13 Prozent auf 29.166 (Vorjahr: 25.779). Gleichzeitig stieg der Umsatz pro Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt um 55 Prozent auf 267.644 Euro (Vorjahr: 172.662 Euro).

Um den großen Bedarf an Fachkräften mit Berufserfahrung und Hochschulabsolventen zu decken, erweiterte Infineon seine Rekrutierungsaktivitäten deutlich. Insbesondere in Deutschland leidet die Halbleiterindustrie unter einem generellen Fachkräftemangel. Dem begegnete der Konzern mit dem Abschluss eines Ergänzungstarifvertrages zum Ausweiten der 40-Stunden-Woche auf den größten Teil der über 6000 Angestellten in Bayern mit Wirkung zum 1. April 2000. Weiterhin werden von Infineon in Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen neue Berufsbilder entwickelt sowie intern die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter voran getrieben.

Um die Motivation der Mitarbeiter und deren Identifikation mit Infineon weiter zu erhöhen, wurde zum Börsengang ein Beteiligungsprogramm aufgelegt, das international Maßstäbe gesetzt hat: Etwa 97 Prozent der Infineon-Mitarbeiter weltweit wurden beim Börsengang bis zu 9,3 Millionen Aktien bevorrechtigt angeboten. 74 Prozent davon beteiligten sich an dem Programm, das je nach Angebot aufgrund verschiedener nationaler und internationaler Rechtsvorschriften eine Sperrfrist zum Verkauf der Aktien zwischen vier Monaten und sechs Jahren vorsieht.

Umfangreicher Aktienoptionsplan bindet Spitzenkräfte

Um insbesondere Spitzenkräfte stärker an Infineon zu binden sowie Unternehmen mit hochwertigen geistigen Eigentumsrechten sowie deren Mitarbeiter einfacher akquirieren zu können, hat die Gesellschaft vor dem Börsengang einen Aktienoptionsplan für bis zu 48 Millionen Aktien beschlossen: In den nächsten fünf Jahren können an Mitglieder des Vorstandes Optionen zum künftigen Erwerb von bis zu 2,25 Millionen Aktien, an Mitglieder der Geschäftsführungen von Tochtergesellschaften bis zu 6 Millionen Aktienoptionen und an Führungskräfte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen - insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung - bis zu 39,75 Millionen Aktienoptionen ausgegeben werden. Jährlich dürfen bis zu 30 Prozent von den im Plan vorgesehenen Optionen gewährt werden. Erstmals wurden beim Börsengang 5,54 Millionen Optionen ausgegeben.

Der Ausübungspreis für eine Aktie entspricht 120 Prozent des durchschnittlichen Aktienpreises der letzten fünf Handelstage vor dem Ausgabetag der Optionen; bei den zum Börsengang gewährten Optionen wurden dafür 42 Euro festgesetzt, also 120 Prozent des Emissionspreises von 35 Euro. Die Optionen können frühestens zwei Jahre und spätestens sieben Jahre nach ihrer Gewährung ausgeübt werden, wenn der Ausübungspreis an mindestens einem Handelstag der Laufzeit erreicht worden ist.

Erfolgreiches Jahr für alle Geschäftsbereiche

Infineon überprüft ständig seine strategische Positionierung und die daraus abgeleitete Organisation der Geschäftsbereiche, um die seit der Ausgründung aus der Siemens AG positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung fortzuführen.

Neben Investitionen ins wachstumsstarke Kerngeschäft gehört dazu, dass Produktfamilien, die nicht mehr zum Kerngeschäft eines Geschäftsbereiches gehören, verkauft bzw. einem Geschäftsbereich zugeordnet werden, der der Produktfamilie bezüglich Markt- und Kundenprofil sowie Technologiebasis näher steht. Seit dem Berichtsjahr konzentriert sich der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation verstärkt auf Produkte für die Internet-Infrastruktur.

- Daher wurde das Geschäftsfeld Computerperipherie, das im Geschäftsjahr 2000 einen Umsatz von 334 Mio. Euro (Vorjahr: 122 Mio. Euro) erzielte, in den Geschäftsbereich Speicherprodukte übertragen.
- Ferner wurde das Geschäftsfeld Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, das zuletzt einen Umsatz in Höhe von 35 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio. Euro) erwirtschaftete, aus dem Geschäftsbereich Mobile Kommunikation in den Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation übertragen.

Weiter wurden zu Beginn des neuen Geschäftsjahres folgende Änderungen in den Geschäftsbereichen vorgenommen:

- Im Oktober 2000 verkaufte Infineon seine Entwicklungs- und Vertriebsaktivitäten für die Unterhaltungselektronik (Geschäftsfeld Image & Video) an die Micronas Semiconductor Holding AG, Zürich. Dieses Geschäftsfeld erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 139 Mio. Euro (Vorjahr: 120 Mio. Euro).
- Der Vorstand hat bereits entschieden, im Geschäftsjahr 2001 das Geschäftsfeld Infrarot-Bauelemente zu veräußern, das Hochgeschwindigkeits- und lineare Optokoppler anbietet und nicht den Kernaktivitäten des Geschäftsbereiches Drahtgebundene Kommunikation zuzuordnen ist. Dieses Geschäftsfeld erzielte im Geschäftsjahr 2000 einen Umsatz in Höhe von 137 Mio. Euro (Vorjahr: 101 Mio. Euro).

Hervorragendes Umsatz- und Ergebniswachstum bei Chips für Kommunikationssysteme

In den Segmenten Mobile Kommunikation, Drahtgebundene Kommunikation sowie Sicherheits- und Chipkarten-ICs (ohne Opto) konnte Infineon seinen Umsatz um 36 Prozent auf 2.536 Mio. Euro (Vorjahr: 1.861 Mio. Euro) und das EBIT (Ergebnis vor Zinsen, vor Abzug auf konzernfremde Gesellschafter entfallender Ergebnisanteile und Steuern) um 57 Prozent auf 388 Mio. Euro (Vorjahr: 247 Mio. Euro) deutlich steigern. Und das trotz der begrenzten internen und externen Produktionskapazitäten.

Mobile Kommunikation: Systemlösungs-Kompetenz aufgebaut

Bei führenden Herstellern von Mobiltelefonen und mobiler Kommunikationsinfrastruktur baute Infineon seinen Lieferanteil im Berichtsjahr weiter aus. Damit verzeichnete der Geschäftsbereich Mobile Kommunikation eine Umsatzsteigerung um 41 Prozent auf 1.221 Mio. Euro (Vorjahr: 865 Mio. Euro).

Trotz der enormen Aufwendungen für Zukunftstechnologien wie UMTS und Bluetooth sowie des Fertigungsanlaufs neuer Produkte stieg im Geschäftsjahr 2000 das EBIT um 43 Prozent auf 261 Mio. Euro (Vorjahr: 182 Mio. Euro). Damit konnte wiederum eine EBIT-Marge von über 21 Prozent erreicht werden.

Durch die Übernahme der GSM-Software-Aktivitäten von debis in die neue Gesellschaft Comneon und die Gründung des skandinavischen Unternehmens Danish Wireless Design (DWD) hat der Bereich sein Ziel, umfassendes System- und Implementierungs-Know-how aufzubauen, innerhalb eines Geschäftsjahres

erreicht. Damit können von Infineon komplette Systemlösungen inklusive Hardware-Design, Chipsets und Software angeboten werden.

Drahtgebundene Kommunikation: Bereich neu ausgerichtet

Die begonnene Restrukturierung des Geschäftsbereiches Drahtgebundene Kommunikation führte bereits im Berichtsjahr zu deutlichen Erfolgen. Mit neuen Produkten für die boomenden Märkte der Internet-Infrastruktur sowie verstärkten Beziehungen zu Schlüsselkunden baute der Bereich seinen Umsatz um 31 Prozent auf 940 Mio. Euro aus (Vorjahr: 720 Mio. Euro). Besonders hohe Wachstumsraten verzeichneten die Komponenten für Glasfaser- und lokale Ethernet-Netzwerke im Gigabit-Bereich.

Das EBIT stieg überproportional zum Umsatz um 90 Prozent auf 78 Mio. Euro (Vorjahr: 41 Mio. Euro). Die weitere Fokussierung auf die Wachstumsmärkte für drahtgebundene - lokale, Weitverkehrs-, Zugangs- und optische - Netzwerktechnologien (LAN, WAN, ACCESS und Optical Networks) trug dazu bei, dass die Sonderbelastung von 60 Mio. Euro aus dem Erwerb von Savan mehr als kompensiert wurde. Vor Berücksichtigung dieser Sonderbelastung errechnet sich ein Ergebnis von 138 Mio. Euro und damit ein deutlich überproportionaler Anstieg des EBIT um 237 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Entsprechend stieg die EBIT-Marge des Geschäftsbereichs auf 15 Prozent nach 6 Prozent im Vorjahr.

Sicherheits- und Chipkarten-ICs: Weltmarktführerschaft behauptet

Die ungebremsst hohe Nachfrage nach SIM-Karten für GSM-Mobiltelefone sowie der Lieferanteil von rund 70 Prozent aller Chips für EC-Geldkarten in Deutschland führten im Geschäftsbereich Sicherheits- und Chipkarten-ICs und Sonstige zu einem Umsatzanstieg von 33 Prozent auf 668 Mio. Euro (Vorjahr: 502 Mio. Euro). Davon entfielen 294 Mio. Euro auf das von Osram und Infineon gemeinsam geführte Unternehmen OSRAM Opto Semiconductors (Vorjahr: 226 Mio. Euro).

Bei Sicherheits- und Chipkarten-ICs erreichte der Bereich ein Umsatzwachstum um 36 Prozent auf 375 Mio. Euro (Vorjahr: 276 Mio. Euro). Davon wurden rund 70 Prozent mit Schlüsselkunden erzielt. Auch deshalb konnte Infineon im Kalenderjahr 1999 seinen Marktanteil bei Smart Cards auf 43 Prozent erhöhen und die Marktführerschaft erfolgreich ausbauen (Quellen: Gartner Dataquest, ZKA, Philips, Infineon). Das absolut höchste Umsatzwachstum erreichte das Geschäftsfeld Chipkarten-Controller. Mit den Produkten MultiMediaCard™ sowie FingerTIP™ wurden erstmals Umsätze im Millionen-Euro-Bereich erzielt. Mit dem reinen Smart Card-Geschäft erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 ein EBIT von 49 Mio. Euro (Vorjahr: 24 Mio. Euro) und erhöhte damit die EBIT-Marge im Jahresvergleich von 9 Prozent auf 13 Prozent.

Der gesamte Geschäftsbereich - inklusive Opto - steigerte das EBIT um 54 Prozent auf 54 Mio. Euro (Vorjahr: 35 Mio. Euro). Trotz der infolge des höheren Anteils an Fremdfertigung in Silicon Foundries gestiegenen Produktionskosten sowie einmaliger Hochlaufkosten für neue Produkte, konnte der Bereich seine EBIT-Marge im Verhältnis zum Umsatz auf 8 Prozent leicht erhöhen (Vorjahr: 7 Prozent).

Speicherprodukte: Herausragend bei Umsatz und Ergebnis

Der Geschäftsbereich Speicherprodukte hat seinen Umsatz um 147 Prozent auf 3.473 Mio. Euro erhöht (Vorjahr: 1.406 Mio. Euro). Damit wuchs der Bereich doppelt so schnell als der gesamte DRAM-Markt. Hauptgründe dafür waren die durchschnittlich erzielten hohe Preise, signifikante Produktivitätssteigerungen unter Einsatz neuester Technologien sowie der Ausbau der Beziehungen zu den sieben größten Kunden, mit denen über 50 Prozent des Umsatzes erzielt werden. Dank der weiteren Optimierung der Herstellungsprozesse wurde die Technologie- und Kostenposition nochmals verbessert.

Zusammen mit den durchschnittlich gestiegenen Preisen für Speicherchips und Lizenzumsätzen in Höhe von 156 Mio. Euro führte die höhere Produktivität beim EBIT des Geschäftsbereiches zu einem Rekordwachstum um 1.574 Mio. Euro auf 1.336 Mio. Euro (Vorjahr: -238 Mio. Euro). Die EBIT-Marge dieses Geschäftsbereichs lag damit bei 38 Prozent.

Automobil- und Industrieelektronik: Umsätze stark ausgeweitet

Dank der anhaltend hohen Nachfrage nach Chips für Automobil- und Industrieanwendungen sowie neuer Aufträge bedeutender Kunden in den Regionen Asien/Pazifik und Japan steigerte der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik seinen Umsatz um 32 Prozent auf 880 Mio. Euro (Vorjahr: 665 Mio. Euro). Damit lag Infineon über dem Marktwachstum und will so die im Kalenderjahr 1999 im Segment Automobilindustrie (ohne Autoradios) erreichte Position als Nummer eins in Europa und Nummer zwei weltweit festigen. Das EBIT des Bereichs verdreifachte sich auf 69 Mio. Euro (Vorjahr: 23 Mio. Euro) und führte zu einer EBIT-Marge von 8 Prozent (Vorjahr: 3 Prozent).

Mit einer erweiterten Kundenbasis, neuen Produkten und der Fokussierung auf Power Management ICs - Chips zum Steuern der Stromversorgung zum Beispiel bei Mobiltelefonen, Motherboards und IT-Infrastrukturen - wurde im Geschäftsfeld Power Management & Supply der Umsatz verdoppelt.

Die in der Industrieelektronik positionierte Tochtergesellschaft eupec hat im Berichtsjahr einige Großaufträge bei Anbietern für Energieübertragung und Antriebstechnik gewonnen. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, wird der Standort Pretzfeld bis Anfang des Jahres 2002 geschlossen und die Fertigung bipolarer Hochleistungs-Bauelemente an den Standorten Warstein und Cegléd (Ungarn) konzentriert.

Darstellung der Ertragslage

Konzernüberschuss vervielfacht

Infineon steigerte im Geschäftsjahr 2000 seinen Umsatz um 72 Prozent auf 7.283 Mio. Euro (Vorjahr: 4.237 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis stieg dabei auf 3.172 Mio. Euro bzw. rund 44 Prozent des Umsatzes (Vorjahr: 1.227 Mio. Euro bzw. 29 Prozent). Entsprechend wurde die Bruttomarge vom Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozentpunkte erhöht. Gründe dafür waren die relativ stabilen Preise durch den Nachfrageüberhang und die Senkung der Stückkosten infolge kleinerer Chipstrukturen und einer höheren Ausbeute.

Der Konzern investierte weiter stark in die Entwicklung zukunftssträchtiger Produkte und Prozesstechnologien. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen absolut um 39 Prozent auf 1.025 Mio. Euro (Vorjahr: 739 Mio. Euro). Im Verhältnis zum Umsatz reduzierten sie sich auf 14 Prozent (Vorjahr: 17 Prozent).

Die Vertriebskosten und allgemeinen Verwaltungskosten stiegen absolut um 22 Prozent auf 670 Mio. Euro (Vorjahr: 551 Mio. Euro). Hauptgrund dafür war der wachstumsbedingte Ausbau des Vertriebsnetzes und der Verwaltungsbereiche. Relativ zum Umsatz verringerte sich der Anteil dieser Kosten auf 9 Prozent (Vorjahr: 13 Prozent).

Das Zinsergebnis spiegelt die gute Finanzausstattung von Infineon wider und erhöhte sich um 72 Prozent auf 75 Mio. Euro (Vorjahr: 43 Mio. Euro).

Das Ergebnis von Beteiligungsgesellschaften, an denen Infineon zwischen 20 und 50 Prozent der Anteile hält, wird nach der Equity-Methode konsolidiert. Der Infineon zuzurechnende anteilige Überschuss dieser Gesellschaften hat sich auf 101 Mio. Euro nahezu verdreifacht (Vorjahr: 34 Mio. Euro). Dieser Zuwachs entfällt überwiegend auf die taiwanesischen Beteiligung ProMOS Technologies, die vom Boom bei Speicherchips profitierte.

Infineon realisierte im Geschäftsjahr 2000 einen Ertrag in Höhe von 53 Mio. Euro aus einer Wertsteigerung ihrer Aktien an ProMOS Technologies durch eine Kapitalerhöhung, an der Infineon nicht teilnahm.

Aufgrund des hohen Vorsteuerergebnisses von 1.738 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio. Euro) entstand im Geschäftsjahr 2000 eine Steuerbelastung von 612 Mio. Euro, was einer Konzern-Steuerquote von 35 Prozent entspricht. Im Vorjahr wies Infineon wegen der Verluste in Deutschland einen Steuerertrag von 30 Mio. Euro aus.

Der Konzernüberschuss vervielfachte sich von 61 Mio. Euro im Vorjahr auf 1.126 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2000. Diese hervorragende Ergebnisentwicklung führte zu einer Umsatzrendite von 15 Prozent (Vorjahr: 1 Prozent).

Basierend auf dem gewichteten Mittel der im Umlauf befindlichen Aktien und unter Berücksichtigung des Verwässerungseffektes aus gewährten Aktienoptionen vervielfachte sich der Gewinn je Aktie bei 615.121.186 Aktien auf 1,83 Euro (Vorjahr: 0,10 Euro bei 600.000.000 Aktien).

Darstellung der Finanzlage

Free Cash Flow erheblich verbessert

Der Free Cash Flow, also die Differenz von Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit und Mittelabflüssen für Investitionen, verbesserte sich im Geschäftsjahr um 203 Mio. Euro auf -247 Mio. Euro (Vorjahr: -450 Mio. Euro). Zu den Mittelabflüssen für Investitionen zählen dabei auch kurzfristig verfügbare Rentenpapiere in Höhe von 452 Mio. Euro. Rein betriebswirtschaftlich werden diese täglich veräußerbaren Wertpapiere jedoch als Zahlungsmittel betrachtet, so dass der betriebswirtschaftliche Free Cash Flow von Infineon im Berichtsjahr bei 205 Mio. Euro lag. Das entspricht einem Anstieg um 655 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit vervierfachten sich auf 2.080 Mio. Euro (Vorjahr: 469 Mio. Euro). Hauptgründe dafür sind der gewachsene Konzernüberschuss und die Verminderung des Nettoumlaufvermögens unter anderem durch verstärktes Asset Management sowie die Ausweitung der Lieferantenverbindlichkeiten und der Rückstellungen.

Die Mittelabflüsse für Investitionen haben sich mit dem Anstieg auf 2.327 Mio. Euro mehr als verdoppelt (Vorjahr: 918 Mio. Euro). Neben Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 1.571 Mio. Euro investierte Infineon 303 Mio. Euro in Beteiligungen und 452 Mio. Euro in kurzfristig verfügbare Rentenpapiere.

Die Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeiten summieren sich im Geschäftsjahr auf 719 Mio. Euro (Vorjahr: 465 Mio. Euro). Hier wirken insbesondere die Kapitalerhöhungen von 821 Mio. Euro, aus denen langfristige Darlehen in Höhe von rund 500 Mio. Euro - im wesentlichen für White Oak Semiconductors an Siemens - getilgt wurden. Zudem schloss Infineon im ersten Quartal des Berichtsjahres die Finanzierungskonten mit Siemens mit einer positiven Wirkung von 341 Mio. Euro. Der Bestand an Zahlungsmitteln stieg auf 511 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio. Euro).

Um die Finanzlage des Konzerns mittelfristig abzusichern, hat Infineon mit einem Bankenkonsortium zwei in gleiche Tranchen aufgeteilte Kreditlinien über insgesamt 750 Mio. Euro vereinbart. Die Laufzeiten betragen vier Jahre bzw. ein Jahr jeweils mit Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr. Bisher wurden diese Kreditlinien nicht in Anspruch genommen.

Darstellung der Vermögenslage

Kapitalstruktur und Kapitalrendite weiter stark verbessert

Das bilanzierte Gesamtvermögen von Infineon erhöhte sich zum 30. September 2000 um 37 Prozent auf 8.853 Mio. Euro (Vorjahr: 6.445 Mio. Euro).

Die Zahlungsmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens stiegen auf 1.009 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio. Euro). Das Anlagevermögen wuchs um 28 Prozent auf 5.018 Mio. Euro (Vorjahr: 3.922 Mio. Euro). Dies reflektiert insbesondere die Investitionen in Sachanlagevermögen und Beteiligungen.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich im Vergleich zum Vermögenswachstum unterproportional um 10 Prozent auf 3.046 Mio. Euro (Vorjahr: 2.790 Mio. Euro). Einerseits wuchsen die Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen durch die Geschäftsausweitung und die Investitionstätigkeit deutlich um 95 Prozent auf 849 Mio. Euro (Vorjahr: 435 Mio. Euro). Andererseits wurden die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute um 363 Mio. Euro auf 266 Mio. Euro zurückgeführt. Im September 2000 gründete die Infineon Technologies AG den Infineon Pension-Trust Verein und übertrug diesem zur treuhänderischen Verwaltung Anteile an einem Spezialfonds, der für diesen Zweck bereits im

Geschäftsjahr 1999 aufgelegt wurde. Das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Konzerns verringerten sich hierdurch um jeweils rund 150 Mio. Euro.

Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich im Geschäftsjahr um 59 Prozent auf 5.806 Mio. Euro (Vorjahr: 3.655 Mio. Euro). Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66 Prozent (Vorjahr: 57 Prozent). Die Eigenkapitalrentabilität wuchs - trotz Kapitalerhöhungen - durch den Ergebnisanstieg erheblich auf 19 Prozent (Vorjahr: 2 Prozent).

Besonders wesentlich zur Beurteilung der finanziellen Stabilität von Halbleiterunternehmen ist die Kennziffer Net cash – der Saldo aus den Finanzforderungen und Finanzverbindlichkeiten. Infineon verbesserte die Net Cash-Position um 1.178 Mio. Euro auf 1.123 Mio. Euro (Vorjahr: -55 Mio. Euro).

Ausgezeichnete Ergebnisentwicklung auch bei der Infineon Technologies AG

Die Infineon Technologies AG, die Führungsgesellschaft des Konzerns, stellt ihren Jahresabschluss nach den Regeln des HGB auf.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Infineon Technologies AG verbesserte sich im zwölf Monate umfassenden Berichtsjahr gegenüber dem Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 30. September 1999 in allen wesentlichen Positionen: Die Umsatzerlöse stiegen auf 7.626 Mio. Euro (1. April bis 30. September 1999: 2.574 Mio. Euro), der Jahresüberschuss erreichte 520 Mio. Euro nach einem Fehlbetrag vom 1. April bis 30. September 1999 von -81 Mio. Euro). Aufgrund der betriebsbedingten Abrechnungsstruktur im Infineon-Konzern mit der AG als Verrechnungs-Drehscheibe für die Lieferungen und Leistungen der produzierenden und vertreibenden Tochtergesellschaften weist die Muttergesellschaft höhere Umsätze aus als der Konzern.

Die Vermögens- und Finanzlage ist einerseits geprägt durch den deutlichen Anstieg des Finanzanlagevermögens sowie durch die Lieferungs- und Leistungsforderungen infolge der starken Geschäftsausweitung. Andererseits ist das Eigenkapital durch Kapitalerhöhungen sowie den hohen Jahresüberschuss auf 6.276 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 4.885 Mio. Euro). Daraus ergibt sich die - für die Halbleiterindustrie nicht ungewöhnlich - hohe Eigenkapitalquote von 75 Prozent (Vorjahr: 74 Prozent).

Vorstand will Dividende ausschütten

Obwohl die Gesellschaft im Börsenzulassungsprospekt/Verkaufprospekt vom März 2000 eine Dividendenausschüttung nicht in Aussicht gestellt hat, möchte der Vorstand die Aktionäre von Infineon an der ausgezeichneten Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2000 beteiligen. Aufgrund der noch gültigen Spreizung von Ausschüttungs- und höherem Einbehaltungs-Steuersatz ist es außerdem günstiger, die Aktionäre an der positiven Ergebnisentwicklung teilhaben zu lassen und bei Bedarf eine Kapitalerhöhung durchzuführen.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von 0,65 Euro je auf den Namen lautende Stückaktie zu zahlen. Sofern die Hauptversammlung dem Vorschlag zustimmt, wird insgesamt ein Betrag von 407 Mio. Euro ausgeschüttet. Anrechnungsberechtigte Aktionäre erhalten zusätzlich eine Steuergutschrift von rund 0,28 Euro je Aktie und damit insgesamt rund 0,93 Euro je auf den Namen lautende Stückaktie.

Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Da Siemens gegenwärtig 71 Prozent des Grundkapitals der Infineon Technologies AG hält und ein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen Infineon und Siemens nicht besteht, hat der Vorstand der Infineon Technologies AG gemäß § 312 Aktiengesetz einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erstellen, den sogenannten Abhängigkeitsbericht.

Im Abhängigkeitsbericht wird erklärt, dass die Infineon Technologies AG bei allen Rechtsgeschäften und allen Maßnahmen mit verbundenen Unternehmen nach den Umständen, die zu dem Zeitpunkt bekannt waren, zu dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt worden ist.

Der Abhängigkeitsbericht ist vom Abschlussprüfer geprüft und ohne Einschränkung mit einem Bestätigungsvermerk versehen worden.

Risikobericht

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Halbleitergeschäft ist mit großen Chancen, aber auch mit erheblichen Risiken verbunden, die sich vor allem in den wirtschaftlichen Ergebnissen und damit auch in der Kursentwicklung von Chip-Aktien widerspiegeln. Grund dafür ist der außerordentlich schnelle technologische Wandel. Er erfordert hohe Investitionen in Produktionskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung, die mit keiner anderen Branche vergleichbar sind. Nur wenn Infineon mit diesem Wandel Schritt hält wie bei der Verkleinerung der Chipstrukturen oder ihn sogar entscheidend mitbestimmt, zum Beispiel bei der Einführung der 300-Millimeter-Technologie, wird die Gesellschaft ihre starke Position in der Halbleiterindustrie festigen oder sogar ausbauen können.

Die Halbleiterbranche ist seit Jahrzehnten der entscheidende Fortschrittstreiber der Elektronikindustrie. Entsprechend ist für eine ertragreiche Zukunft von Infineon eine mit hohen Kosten verbundene rechtzeitige Markteinführung neuer Halbleiterprodukte unerlässlich. Aktuelle Beispiele dafür sind die neuen Chips für Bluetooth- und UMTS-Anwendungen. Eine wesentliche Chancen- und Risikokomponente beinhaltet aber auch die äußerst unbeständige Preisentwicklung bei Speicherchips. Der Vorstand von Infineon verfolgt hierbei die Strategie, als Kostenführer in guten Zeiten den Ertrag zu maximieren und in weniger guten Zeiten Verluste zu minimieren.

Integriertes Risiken- und Chancen-Management

Um die Chancen zu nutzen, die sich im insgesamt attraktiven Marktumfeld der Halbleiterindustrie bieten, und Unsicherheiten erfolgreich zu überwinden, hat Infineon ein unternehmensweites Risiko- und Chancenmanagement eingerichtet, das vom Abschlussprüfer im Rahmen des Jahresabschlusses geprüft wurde. Ziel des Managements von Infineon ist dabei nicht das Vermeiden, sondern die umfassende Kenntnis aller potentiellen Risiken und ihrer Zusammenhänge. Ein solches Verständnis schafft Handlungsspielräume und erlaubt Managemententscheidungen unter Kenntnis der damit verbundenen Risiken.

Infineon versteht das effiziente und vorausschauende Risiko- und Chancenmanagement als wichtige und wertschöpfende Aufgabe. Um Risiken und Chancen beurteilen, überwachen und steuern zu können, nutzt der Konzern eine Vielzahl von Steuerungs- und Kontrollsystemen, die laufend weiterentwickelt werden. Dazu gehören aufeinander abgestimmte Strategie-, Planungs- und Budgetierungs-Prozesse. Kernstück des Systems bilden Risiko- und Chancenberichte aller Bereiche, die regelmäßig erstellt und in den verschiedenen Leitungsgremien diskutiert werden. Sie bilden eine wesentliche Grundlage für die Entscheidungen des Managements. Begleitet werden diese ferner von strukturierten Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie regelmäßigen Benchmarking-Prozessen.

Vermeidung von Einzelrisiken

Im Rahmen des Risiko- und Chancen-Managements trifft Infineon umfangreiche Vorkehrungen insbesondere bei wesentlichen Einzelrisiken:

- Gegen Produkt Risiken sichert sich der Konzern durch ein engmaschiges Netz von Qualitätskontrollen ab, die wichtige Lieferanten mit einbeziehen. Alle Standorte sind nach der Norm ISO 9000 beziehungsweise QS-9000 zertifiziert.
- Der Konzern schützt sich mit Versicherungen weitgehend gegen Bedrohungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beim Eintritt von Haftungsrisiken oder Schadensfällen.
- Steuerliche, wettbewerbs-, patent-, umwelt- und börsenrechtliche Regelungen können Unternehmensrisiken beinhalten. Die Gesellschaft lässt sich deshalb umfassend von internen und externen Fachleuten beraten.
- Durch weltweite Geschäftsaktivitäten können Währungsrisiken entstehen, insbesondere in den Kursrelationen des Euro gegenüber dem US-Dollar und dem japanischen Yen. Diese werden bei Infineon nur teilweise durch Bezüge, Fertigungen oder Finanzierungen in lokalen Währungen ausgeglichen. Der größte Teil der verbleibenden Netto-Positionen wird durch derivative Finanzinstrumente abgesichert. Zu Spekulationszwecken setzt die Gesellschaft derivative Finanzinstrumente jedoch nicht ein.

Aktuelle Beurteilung des Gesamtrisikos

Die aktuelle Überprüfung der Risikosituation hat ergeben, dass im Geschäftsjahr 2000 keine den Fortbestand der Gesellschaft bedrohenden Risiken bestanden haben und auch für die Zukunft nicht zu erkennen sind.

Nach Jahresabschluss Geschäfts- und Beteiligungsportfolio weiter optimiert

Infineon hat Anfang Oktober 2000 einen Vertrag für den Erwerb sämtlicher Anteile an der Firma Ardent Technologies mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, zu einem Kaufpreis von 42 Mio. US-Dollar abgeschlossen. Ardent ist spezialisiert auf hochintegrierte Schaltungen in breitbandigen Switching-Systemen und verfügt über ein breites Produktportfolio für Fast- und Gigabit-Ethernets. Die Akquisition erweitert die Präsenz des Geschäftsbereichs Drahtgebundene Kommunikation von Infineon im schnell wachsenden Chipmarkt für lokale Unternehmensnetzwerke (LAN).

Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres übernahm die Tochtergesellschaft Sci-worx GmbH in Hannover die wesentlichen Geschäftsaktivitäten der Sican GmbH, einem der größten unabhängigen Designhäuser Europas für Kommunikations-ICs. Mit rund 300 Mitarbeitern entwickelt und vermarktet Sci-worx System-on-Chip-Lösungen für die sichere mobile und drahtgebundene Kommunikation und ergänzt damit den Geschäftsbereich Sicherheits- und Chipkarten-ICs.

Infineon erwarb darüber hinaus im Oktober 2000 - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörde - den 50-prozentigen Anteil von Motorola Inc. an dem Gemeinschaftsunternehmen Semiconductor 300 GmbH & Co. KG mit Sitz in Dresden. Gleichzeitig haben sich der Freistaat Sachsen und die Jenoptik-Tochter M+W Zander an der Gesellschaft beteiligt, die die weltweit erste Chip-Volumenfertigung auf 300-Millimeter-Siliziumscheiben errichtet.

Infineon hat im Oktober 2000 seine Entwicklungs- und Vertriebsaktivitäten für die Unterhaltungselektronik veräußert. Dieser Teilbereich namens "Image & Video" mit 130 Mitarbeitern wird - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörde - wirtschaftlich rückwirkend zum 1. August 2000 von der Micronas Semiconductor Holding AG, Zürich für 250 Mio. Euro übernommen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2001

Industrieanalysten: langfristig starkes Marktwachstum

Organisationen wie die WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) und unabhängige Marktforschungsinstitute wie Gartner Dataquest, VLSI Research und Future Horizons prognostizieren für den weltweiten Halbleitermarkt im Kalenderjahr 2001 weiterhin kräftige Wachstumsraten. Das Marktwachstum soll demnach in allen Regionen anhalten und vor allem in den Regionen USA sowie Asien-Pazifik überdurchschnittlich ausfallen. Der Anstieg der Nachfrage wird den Industrieanalysten zufolge mit einem niedrigeren zweistelligen Prozentwachstum bis ins Jahr 2002 anhalten.

Seit August 2000 gingen die durchschnittlich erzielten Preise für DRAMs wieder kontinuierlich zurück. Dieser Rückgang wurde als Reaktion auf hohe Lagerhaltungsquoten bei den PC-Herstellern und Zwischenhändlern gewertet. Zu Beginn des Jahres 2001 erwarten einige Marktforschungsinstitute wie zum Beispiel Gartner Dataquest (Stand: Oktober 2000) wieder höhere Preise aufgrund abnehmender Lagerbestände, wieder zunehmender Auftragseingänge sowie einem Nachfrageüberhang bei einigen Speicherprodukten. Jedoch kann niemand versichern, dass die vorhergesagten Preiserhöhungen tatsächlich eintreten.

Auch in der längerfristigen Vorschau bis zum Jahr 2004 prognostizieren die Industrieanalysten wie Gartner Dataquest für den Halbleitermarkt nach wie vor zwar volatile aber dennoch durchschnittlich zweistellige jährliche Wachstumsraten. Auch wenn diese abfallen können, bleibt der Vorstand zuversichtlich, dass der Halbleitermarkt - wie schon in der Vergangenheit - langfristig höhere Wachstumsraten erreichen wird als viele andere Industriesparten wie Elektronik, Automobil und Chemie.

Investitionsvolumen der Chipindustrie nimmt zu

Die Unternehmen der Halbleiterindustrie planen nach Angaben von Gartner Dataquest (Stand: Oktober 2000) in den Jahren 2001 und 2002 ihr Investitionsvolumen voraussichtlich stark auszuweiten und insgesamt etwa 30 Prozent der Umsätze in neue Kapazitäten zu investieren. Trotz der angekündigten hohen Investitionen insbesondere in neue 300-Millimeter Fabriken erwartet Gartner Dataquest, dass die Investitionsquoten der reinen Speicherchip-Hersteller unter dem Durchschnitt der gesamten Industrie liegen werden. Die höchsten Quoten wurden von den taiwanesischen Silicon Foundries TSMC sowie UMC gemeldet. Infineon selbst plant im Geschäftsjahr 2001 mit einem Investitionsbudget von 30 Prozent des Umsatzes; direkte Wettbewerber von Infineon im Nicht-Speicherbereich planen mit etwas höheren Investitionsvolumina.

Infineon will vom Marktwachstum überproportional profitieren

Wegen der hervorragenden Kosten- und Wettbewerbsposition von Infineon bei Speicherchips und der weiteren Fokussierung der Nicht-Speicherbereiche auf wachstumsstarke Kommunikationssegmente strebt der Vorstand an, dass Infineon weiterhin überproportional von der Marktentwicklung profitiert. Dies wird durch einen weiter starken Ausbau der Fertigungskapazitäten an den bestehenden Standorten sowie durch zusätzliche Produktivitätsfortschritte wie die geplante Einführung der 300-Millimeter-Technologie im Geschäftsjahr 2002 unterstützt. Infolge des Hochlaufs der 300-Millimeter Speicherchip-Fertigung werden die in Dresden frei werdenden 200-Millimeter Produktionskapazitäten nach und nach ebenfalls auf Chips für Kommunikationssysteme umgestellt.

Günstigere steuerliche Bedingungen ab 2002

Die neuen Regelungen aus der jüngsten Unternehmens-Steuerreform der deutschen Bundesregierung gelten für Infineon überwiegend mit Beginn des Geschäftsjahres 2002 ab dem 1. Oktober 2001. Mit der Reform wird der Körperschaftssteuersatz auf 25 Prozent gesenkt und gilt einheitlich für ausgeschüttete und thesaurierte Gewinne. Ferner wird die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften im Inland unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr besteuert. Die Gegenfinanzierung der Steuermindereinnahmen der öffentlichen Hand wird im wesentlichen durch eine Absenkung der Abschreibungssätze erfolgen.

Insgesamt erwartet Infineon aufgrund dieser Änderungen in Deutschland eine leichte Senkung der Steuerquote im Geschäftsjahr 2002.

Kommunikationssysteme

Der Chipmarkt für Kommunikationssysteme wird weiter vorangetrieben durch den Auf- und Ausbau von hochmodernen Breitband- und optischen Infrastrukturen, die das Surfen und den elektronischen Handel im Internet beschleunigen. Die ständig wachsende Nachfrage nach mobilen Kommunikationsgeräten mit mehreren integrierten Funktionen ist Wegbereiter für neue Technologien wie UMTS und Bluetooth. Diese erfordern zunehmend in den Chipsystemen integrierte Softwarelösungen sowie leistungsfähigere Power Management-Anwendungen.

Mobile Kommunikation

Mit dem vorhandenen kompletten Produktportfolio für mobile Kommunikationsgeräte will der Geschäftsbereich seinen Marktanteil weiter ausbauen, den Umsatz innerhalb von zwei Jahren stark erhöhen und damit seine führende Position langfristig festigen. Dafür wird die Eigenproduktion insbesondere auf Basis der Gallium-Arsenid- und Silizium-Germanium-Technologien ausgebaut. Zudem werden weitere Silicon Foundry-Kapazitäten genutzt.

Mit dem System-Know-how, das grundsätzlich allen Kunden angeboten wird, sollen vor allem in Asien expandierende OEM-Hersteller als neue Kunden gewonnen werden. Die OEM-Firmen produzieren zum Beispiel im Auftrag von Markenunternehmen Mobiltelefone für Marktsegmente mit niedrigem Preisniveau. Im neuen Geschäftsjahr werden vor allem die neu vorgestellten Chipsets für UMTS- und Bluetooth-Anwendungen weiterentwickelt. Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Mobiltelefon-Herstellern in Europa und Japan will Infineon auch künftig als erster noch kompaktere und günstigere System-on-Chip-Lösungen anbieten.

Drahtgebundene Kommunikation

Mit dem Abschluss der Restrukturierung des Geschäftsbereiches Drahtgebundene Kommunikation will Infineon im neuen Geschäftsjahr die Rentabilität des Bereiches weiter verbessern. Nach der Eingliederung von Ardent wird die Akquisitions- und Investitionsstrategie fortgeführt, um den Bereich noch stärker in den Wachstumsmärkten LAN, WAN und ACCESS und Optical Networks zu positionieren.

Um die Umsatz- und Ergebnisbeiträge des Geschäftsfeldes Fiber Optics zu erhöhen, wird das Management Logistikprozesse umorganisieren sowie neu installierte Produktionstechnologien hochfahren und weiter optimieren. Bei der Entwicklung neuer xDSL-Chipsets strebt Infineon an, Marktführer der nächsten ACCESS-Generation zu werden.

Sicherheits- und Chipkarten-ICs

Der Geschäftsbereich Sicherheits- und Chipkarten-ICs (ohne OSRAM Opto Semiconductors) startete gemäß Gartner Dataquest als Marktführer bei Chipkarten-ICs in das neue Geschäftsjahr. Diese Position soll mittels weiter verkleinerter Chipstrukturen sowie der Umstellung auf noch leistungsfähigere Produkte verteidigt werden. Im Geschäftsjahr 2001 strebt Infineon an, dass auch im Segment Sicherheits-ICs der technische Vorsprung in ein signifikantes Umsatzwachstum mündet. Insgesamt erwartet der Geschäftsbereich im Geschäftsjahr 2001 ein signifikantes Umsatzwachstum.

Dafür vergrößert Infineon das Produktportfolio um neue Verschlüsselungs-Bauelemente und weiterentwickelte biometrische Sensoren. Der Marktanteil der MultiMediaCard™ soll mit Hilfe strategischer Allianzen erhöht werden. Darüber hinaus will Infineon seine Sicherheitskompetenz und die hervorragenden Kundenbeziehungen nutzen, um ins Dienstleistungsgeschäft für Sicherheit im Bereich der Informationstechnologie einzusteigen.

Speicherprodukte

Infineon erwartet auch im neuen Geschäftsjahr eine in verkauften Megabit gerechnete starke Wachstumsrate des Speicherchip-Marktes von über 60 Prozent. Aufgrund der aktuellen Unsicherheit der weltweiten PC-Märkte erwartet Infineon eine schwächere Nachfrage und daraus folgende niedrigere Preise für Speicherchips im ersten Quartal, das dem letzten Quartal des Kalenderjahres 2000 entspricht.

Insgesamt bleibt der Ausblick des Vorstands für den Geschäftsbereich positiv aufgrund der prognostizierten Markterholung, die spätestens in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres, die dem zweiten und dritten Quartal des Kalenderjahres 2001 entspricht, eintreten soll. Diese Prognose lässt weiterhin sehr zufriedenstellende Geschäftsergebnisse erwarten, die allerdings stark von der strukturell volatilen Preisentwicklung sowie vom Zeitpunkt neu hinzukommender Kapazitäten abhängig sind.

Bis Ende Dezember 2000 wird die Fertigung von DRAM-Standardprodukten komplett auf die kostengünstigere 0,17-Mikrometer-Technologie umgestellt sein, der schon 2001 teilweise die 0,14-Mikrometer-Technologie folgen wird, mit der die Produktivität der 200-Millimeter-Fabriken nochmals erhöht wird. Der Bedarf an Massenmarktprodukten für PCs und Notebooks wird 2001 im wesentlichen durch 128-Megabit Speicher gedeckt. Der Übergang in die weniger volatilen und schneller wachsenden Märkte für Server- und Netzwerkprodukte soll durch den erhöhten Produktionsausstoß von 256-Megabit-Speicherchips beschleunigt werden. Insgesamt streben wir bei DRAMs im Jahr 2001 weiterhin einen Marktanteil von gut 10 Prozent an. Nach Meinung des Vorstands ist damit ein wirtschaftliches Verhältnis zwischen den hohen Ertragschancen und dem Risiko der DRAM-typischen Marktschwankungen erreicht.

Automobil- und Industrieelektronik

Infineon erwartet, dass das über dem Marktdurchschnitt liegende Umsatzwachstum im Bereich Automobil- und Industrieelektronik aufgrund höherer Kapazitäten und einer guten Preisentwicklung auch im neuen Geschäftsjahr anhalten wird. Um die Ergebnissituation nochmals zu verbessern, werden weitere margenschwache Produkte abgesetzt.

Mit einer noch stärkeren Kundenbindung und dem Ausbau der Technologiebasis will der Bereich seinen Marktanteil bei Power Management & Supply erhöhen. Da hier vorwiegend Kunden aus der Region Südostasien führende Positionen im Weltmarkt einnehmen, wird Infineon in Singapur ein spezielles Kompetenzzentrum einrichten. Mit einem angestrebten hohen Umsatzwachstum in den USA will der Konzern im Geschäftsjahr 2001 im amerikanischen Markt für Automobilelektronik eine führende Position einnehmen.

Unterstützt durch einen teilweisen Rückzug der japanischen Hersteller will die eupec ihre Marktposition im Segment der industriellen Antriebstechnik weiter ausbauen. Das Tochterunternehmen wird mit neuen Produkten in den rasch wachsenden Markt für Konsumer-Antriebe in Südostasien eintreten.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Konzern

Um im Geschäftsjahr 2001 weiterhin eine hohe Umsatzrendite erzielen zu können, will Infineon im Speicherchip-Geschäft durch weitere produktivitätssteigernde Maßnahmen seine führende Kostenposition ausbauen. Im Geschäftsjahr 2002 wird dann das frühe Hochfahren der 300-Millimeter-Produktion entscheidend sein für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit im DRAM-Markt.

Insbesondere beabsichtigt der Vorstand, die Abhängigkeit der Konzernergebnisse vom Geschäftsbereich Speicherprodukte zu reduzieren. Neben den bereits hohen Umsatz- und EBIT-Zahlen des Geschäftsbereiches Mobile Kommunikation sollen dazu im neuen Geschäftsjahr überdurchschnittliche Wachstumsraten beim Umsatz und höhere EBIT-Margen der Geschäftsbereiche Drahtgebundene Kommunikation, Sicherheits- und Chipkarten-ICs sowie Automobil- und Industrieelektronik beitragen. Parallel dazu sollen die Marktanteile in einzelnen Kern-Zielmärkten ausgebaut werden

Weiterhin will der Vorstand das Konzernergebnis im neuen Geschäftsjahr durch eine in absoluten Zahlen erhöhte aber im Verhältnis zum Umsatz prozentual niedrigere Investitionsquote für Forschung und Entwicklung positiv beeinflussen. Dafür sollen insbesondere mit Hilfe weiterer Benchmarking-Prozesse

die Durchlaufzeiten und Kosten der Entwicklungsprojekte weiter verringert werden. Die Vertriebskosten und allgemeinen Verwaltungskosten sollen auch in den Folgejahren auf dem bereits wettbewerbsfähigen Niveau gehalten werden.

Derzeit wird zur noch effizienteren Steuerung des gesamten Konzerns die bisher als Pilotprojekt im Bereich Sicherheits- und Chipkarten-ICs erfolgreich eingeführte "Balanced Scorecard" unternehmensweit eingeführt werden.

Der Vorstand erwartet im Geschäftsjahr 2001 für den Konzern einen deutlichen Umsatzzuwachs, der über der Wachstumsrate des Gesamtmarktes liegen soll. Die Entwicklung der Bruttomarge vom Umsatz wird stark abhängig sein von der Entwicklung des Speicherchip-Marktes und soll möglichst auf dem bereits hohen Niveau des Geschäftsjahres 2000 gehalten werden.

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Infineon Technologies AG für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 1999 bis 30. September 2000 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Infineon Technologies AG. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 17. November 2000

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Berger	Wolfs
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.